仅供内部参考，请勿外传

国金证券 SINOLINK SECURITIES

2026 年 09 月 01 日

电子行业研究

买入（维持评级）

行业深度研究

证券研究报告

电子组

分析师：樊志远（执业 S1130518070003） fanzhiyuan@gjzq.com.cn

分析师：丁彦文（执业 S1130524070002） dingyanwen@gjzq.com.cn

算力硬件景气度持续验证，看好 AI-PCB 与自主可控产业链

投资逻辑：

电子行业 2026H1 业绩高增，盈利能力显著改善。电子行业 2026H1 实现营收 24497.22 亿元，同增 30.98%，归母净利润 1737.62 亿元，同增 99.38%，利润增速显著高于收入增速。2026Q2 实现营收 13629.85 亿元，同增 34.81%，归母净利润 1122.95 亿元，同增 124.61%。上半年 AI 云端算力基础设施需求持续高景气，AI 算力硬件产业链业绩快速增长；国内半导体自主可控加速推进，设备、算力芯片及半导体设计板块表现亮眼；端侧 AI 加速渗透及新品周期推动消费电子需求改善。电子行业 2026H1 毛利率为 17.5%，同比约+1.8pct，净利率为 7.1%，同比约+2.4pct，产品结构优化与规模效应推动板块盈利能力持续提升。

受益 AI 算力需求持续高景气，PCB 板块量价齐升。PCB 行业 2026H1 实现营收 1861.21 亿元，同增 36.48%，归母净利润 217.38 亿元，同增 72.66%，利润增速显著高于收入增速。2026Q2 实现营收 1035.87 亿元，同增 47.45%，归母净利润 137.24 亿元，同增 95.67%。2026H1 毛利率为 25.3%，净利率为 11.9%。AI 算力需求持续增长叠加高端产品占比提升，有望继续支撑 PCB、覆铜板及配套设备、电子布、铜箔等产业链景气度。

半导体设备：国产替代持续推进，盈利能力进一步提升。半导体设备行业 2026H1 实现营收 553.73 亿元，同增 26.33%，归母净利润 116.64 亿元，同增 71.94%。2026Q2 实现营收 298.75 亿元，同增 42.01%，归母净利润 72.19 亿元，同增 92.94%。国内晶圆厂资本开支维持较高强度，先进逻辑及存储产线持续扩产，叠加工艺升级带来的设备价值量提升，国产设备厂商订单及收入保持较快增长。持续看好半导体设备及核心零部件自主可控产业链。

存储：周期上行，盈利弹性显著改善。2026H1 营收为 2819.90 亿元，同增 389.89%，归母净利润为 1138.60 亿元，同增 14912.95%。其中，2026Q2 实现营收 1775.15 亿元，同增 433.54%，归母净利润 753.55 亿元，同增 17339.65%。我们认为，AI 算力需求仍将支撑 HBM、企业级 SSD 等高端存储需求，传统 DRAM 与 NAND 供需格局有望维持偏紧。

半导体设计：AI 算力放量共振，盈利弹性显著释放。半导体设计板块 2026H1 实现营收 797.23 亿元，同增 37.13%，归母净利润 192.23 亿元，同增 123.09%。2026Q2 实现营收 451.89 亿元，同增 41.05%；归母净利润 132.79 亿元，同增 157.38%. 国产算力芯片亦随着大模型持续迭代以及训练、推理侧需求扩张加速放量。我们认为，AI 算力需求增长及国产替代仍将成为半导体设计板块的重要驱动力。

消费电子：端侧 AI 持续渗透，新品周期推动需求改善。消费电子行业 2026H1 实现营收 11845.03 亿元，同增 34.11%，归母净利润 497.80 亿元，同增 50.96%。2026Q2 实现营收 6432.60 亿元，同增 34.46%，归母净利润 287.77 亿元，同增 55.13%。上半年端侧 AI 持续推动智能手机、AIPC 及可穿戴设备软硬件升级，叠加新品周期带动换机需求改善，景气度延续。展望下半年及 2027 年，苹果硬件创新、AI 智能眼镜及其他端侧 AI 新品有望继续推动产业链价值量提升。

投资建议与估值

持续看好 AI 算力硬件、半导体自主可控及端侧 AI 创新三条主线。AI 算力方面，随着新一代 GPU 及谷歌、亚马逊等 ASIC 产品持续拉货，AI 服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长，持续看好 AI-PCB、覆铜板及上游配套产业链；半导体方面，国内先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件、材料国产替代持续推进，同时存储周期上行及国产 AI 算力芯片放量带动设计板块盈利改善，持续看好自主可控产业链核心公司；端侧 AI 方面，关注苹果新品周期、AI 智能眼镜及 AIoT 等硬件创新带来的新增需求。

风险提示

终端需求不及预期的风险；AI 技术迭代及商业化进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险；上游原材料价格上涨及成本传导不及预期的风险。

内容目录

一、电子板块：2026H1 营收同增 30.98%，归母净利润同增 99.38% 7
二、子板块：AI 算力硬件及半导体设计业绩表现亮眼 7
2.1：半导体：上游自主化加速，存储需求高增，设备与设计表现较好 8
2.2：消费电子：2026H1 营收同增 34.11%，归母净利同增 50.96% 13
2.3：电子化学品：2026H1 营收同增 24.36%，26H1 归母净利同增 14.24% 14
2.4：元件：PCB 2026H1 营收同增 36.48%，26H1 归母净利同增 72.66% 15
2.5：汽车电子：2026H1 营收同增 25.43%，26H1 归母净利下降 7.10% 17
2.6：光学光电子：2026H1 营收同增 1.41%，26H1 归母净利增加 18.67% 18
2.7：其他电子：2026H1 营收同增 113.77%，26H1 归母净利同增 154.99% 19
三、龙头表现：AI 硬件产业链公司业绩亮眼 20
3.1：消费电子 20
3.2：PCB 23
3.3：被动元件 27
3.4：汽车电子 28
3.5：半导体设计 29
3.6：功率半导体 31
3.7：半导体设备 32
3.8：晶圆代工 34
四、投资建议 35
五、风险提示 35

图表目录

图表 1： 电子行业历史营收情况 7
图表 2： 电子行业历史归母业绩情况 7
图表 3： 电子行业历史盈利能力情况 7
图表 4： 电子行业单季度历史盈利能力情况 7
图表 5： 各子板块所包含个股 8
图表 6： 半导体行业历史营收情况 8
图表 7： 半导体行业历史归母业绩情况 8
图表 8： 半导体行业历史盈利能力情况 9
图表 9： 半导体行业单季度历史盈利能力情况 9
图表 10： 半导体设备行业历史营收情况 9
图表 11： 半导体设备行业历史归母业绩情况 9

图表 12： 半导体设备行业历史盈利能力情况 10
图表 13： 半导体设备行业单季度历史盈利能力情况 10
图表 14： 半导体材料行业历史营收情况 10
图表 15： 半导体材料行业历史归母业绩情况 10
图表 16： 半导体材料行业历史盈利能力情况 10
图表 17： 半导体材料行业单季度历史盈利能力情况 10
图表 18： 功率半导体行业历史营收情况 11
图表 19： 功率半导体行业历史归母业绩情况 11
图表 20： 功率半导体行业历史盈利能力情况 11
图表 21： 功率半导体行业单季度历史盈利能力情况 11
图表 22： 存储行业历史营收情况 12
图表 23： 存储行业历史归母业绩情况 12
图表 24： 存储行业历史盈利能力情况 12
图表 25： 存储行业单季度历史盈利能力情况 12
图表 26： 算力芯片行业历史营收情况 12
图表 27： 算力芯片行业历史归母业绩情况 12
图表 28： 算力芯片行业历史盈利能力情况 13
图表 29： 算力芯片行业单季度历史盈利能力情况 13
图表 30： 半导体设计行业历史营收情况 13
图表 31： 半导体设计行业历史归母业绩情况 13
图表 32： 消费电子行业历史营收情况 14
图表 33： 消费电子行业历史归母业绩情况 14
图表 34： 消费电子行业历史盈利能力情况 14
图表 35： 消费电子行业单季度历史盈利能力情况 14
图表 36： 电子化学品行业历史营收情况 15
图表 37： 电子化学品行业历史归母业绩情况 15
图表 38： 电子化学品行业历史盈利能力情况 15
图表 39： 电子化学品行业单季度历史盈利能力情况 15
图表 40： 元件行业历史营收情况 16
图表 41： 元件行业历史归母业绩情况 16
图表 42： 元件行业历史盈利能力情况 16
图表 43： 元件行业单季度历史盈利能力情况 16
图表 44： PCB 行业历史营收情况 17
图表 45： PCB 行业历史归母业绩情况 17
图表 46： PCB 行业历史盈利能力情况 17

图表 47： PCB 行业单季度历史盈利能力情况 17
图表 48： 汽车电子行业历史营收情况 18
图表 49： 汽车电子行业历史归母业绩情况 18
图表 50： 汽车电子行业历史盈利能力情况 18
图表 51： 汽车电子行业单季度历史盈利能力情况 18
图表 52： 光学光电子行业历史营收情况 19
图表 53： 光学光电子行业历史归母业绩情况 19
图表 54： 光学光电子行业历史盈利能力情况 19
图表 55： 光学光电子行业单季度历史盈利能力情况 19
图表 56： 其他电子行业历史营收情况 20
图表 57： 其他电子行业历史归母业绩情况 20
图表 58： 其他电子行业历史盈利能力情况 20
图表 59： 其他电子行业单季度历史盈利能力情况 20
图表 60： 立讯精密营收情况 21
图表 61： 立讯精密归母净利润情况 21
图表 62： 鹏鼎控股营收情况 21
图表 63： 鹏鼎控股归母净利润情况 21
图表 64： 东山精密营收情况 22
图表 65： 东山精密归母净利润情况 22
图表 66： 传音控股营收情况 22
图表 67： 传音控股归母净利润情况 22
图表 68： 领益智造营收情况 23
图表 69： 领益智造归母净利润情况 23
图表 70： 蓝思科技营收情况 23
图表 71： 蓝思科技归母净利润情况 23
图表 72： 沪电股份营收情况 24
图表 73： 沪电股份归母净利润情况 24
图表 74： 深南电路营收情况 24
图表 75： 深南电路归母净利润情况 24
图表 76： 兴森科技营收情况 25
图表 77： 兴森科技归母净利润情况 25
图表 78： 胜宏科技营收情况 25
图表 79： 胜宏科技归母净利润情况 25
图表 80： 生益科技营收情况 26
图表 81： 生益科技归母净利润情况 26

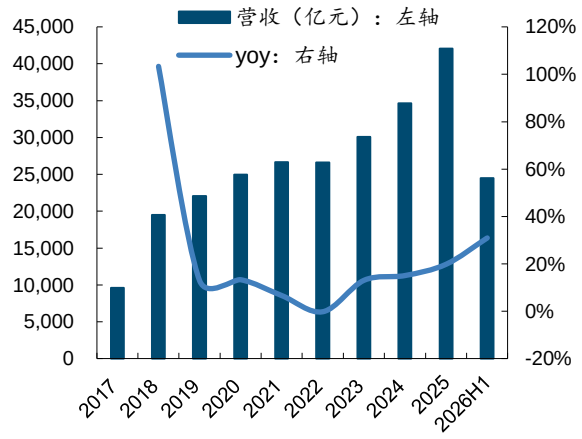
图表 82： 南亚新材营收情况 26
图表 83： 南亚新材归母净利润情况 26
图表 84： 瑞联新材营收情况 26
图表 85： 瑞联新材归母净利润情况 26
图表 86： 顺络电子营收情况 27
图表 87： 顺络电子归母净利润情况 27
图表 88： 三环集团营收情况 27
图表 89： 三环集团归母净利润情况 27
图表 90： 铂科新材营收情况 28
图表 91： 铂科新材归母净利润情况 28
图表 92： 洁美科技营收情况 28
图表 93： 洁美科技归母净利润情况 28
图表 94： 电连技术营收情况 29
图表 95： 电连技术归母净利润情况 29
图表 96： 瑞可达营收情况 29
图表 97： 瑞可达归母净利润情况 29
图表 98： 晶晨股份营收情况 30
图表 99： 晶晨股份归母净利润情况 30
图表 100： 兆易创新营收情况 30
图表 101： 兆易创新归母净利润情况 30
图表 102： 圣邦股份营收情况 31
图表 103： 圣邦股份归母净利润情况 31
图表 104： 澜起科技营收情况 31
图表 105： 澜起科技归母净利润情况 31
图表 106： 新洁能营收情况 32
图表 107： 新洁能归母净利润情况 32
图表 108： 北方华创营收情况 32
图表 109： 北方华创归母净利润情况 32
图表 110： 中微公司营收情况 33
图表 111： 中微公司归母净利润情况 33
图表 112： 精测电子营收情况 33
图表 113： 精测电子归母净利润情况 33
图表 114： 拓荆科技营收情况 34
图表 115： 拓荆科技归母净利润情况 34
图表 116： 芯源微营收情况 34

图表 117： 芯源微归母净利润情况 34
图表 118： 晶合集成营收情况 35
图表 119： 晶合集成归母净利润情况 35

一、电子板块：2026H1 营收同增 30.98%，归母净利润同增 99.38%

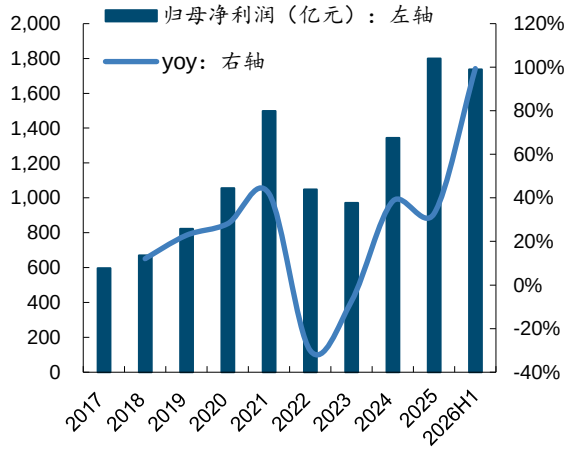
电子行业 2026H1 实现营收 24497.22 亿元，同增 30.98%，归母净利润 1737.62 亿元，同增 99.38%。其中，2026Q2 实现营收 13629.85 亿元，同增 34.81%，归母净利润 1122.95 亿元，同增 124.61%。上半年板块业绩显著提速，主要受益于 AI 云端算力基础设施需求持续高景气、国内半导体自主可控加速推进，以及端侧 AI 渗透带来的消费电子需求改善。其中，AI 算力硬件及半导体相关环节保持较高景气度，收入规模持续扩张，叠加产品结构优化与规模效应释放，板块利润增速显著高于收入增速。展望后续，随着新一代 AI 算力芯片及配套硬件持续放量、端侧 AI 应用加速渗透以及国产半导体产业链持续突破，持续看好 AI 算力核心硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。

图表1：电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

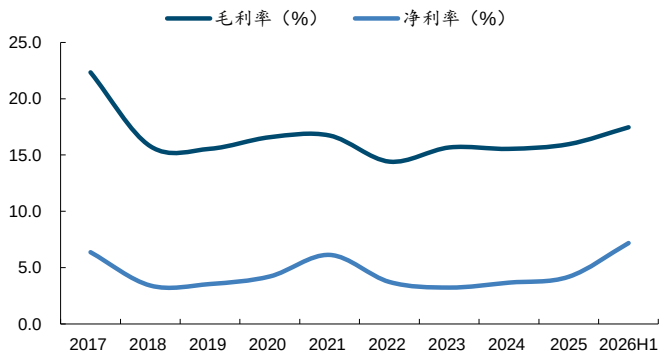
图表2：电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

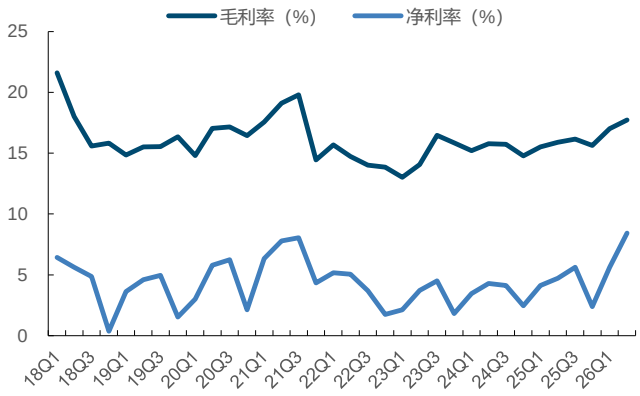
2026H1 电子行业盈利能力进一步改善。电子行业 2026H1 毛利率为 17.5%，同比约+1.8pct，净利率为 7.1%，同比约+2.4pct。26Q2 毛利率为 17.7%，同比+1.8pct，环比+0.7pct；净利率为 8.4%，同比+3.7pct，环比+2.8pct。随着 AI 算力等高景气业务占比提升、产品结构优化及规模效应持续释放，板块盈利能力继续上行。

图表3：电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表4：电子行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

二、子板块：AI 算力硬件及半导体设计业绩表现亮眼

我们重点跟踪半导体（半导体设备、半导体材料、功率半导体、IC 设计等细分板块）、电子元件、消费电子、光学光电子、电子化学品、其他电子、汽车电子的财务数据表现，其中电子元件、消费电子、光学光电子、电子化学品、其他电子、半导体板块所包含个股与申万二级行业分类（2021）一致，半导体设备、半导体材料所包含个股与申万三级行业分类（2021）一致，汽车电子板块包含汽车连接器、汽车光学、汽车显示 3 大子板块，各子板块所包含个股详见图表。

图表5：各子板块所包含个股

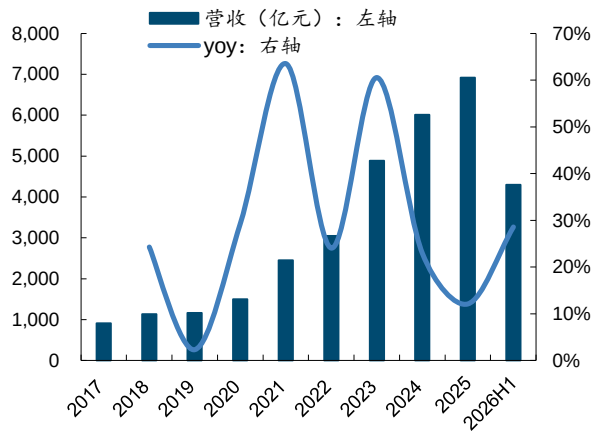
汽车连接器子板块		汽车光学子板块		汽车显示子板块		存储		功率半导体		算力芯片	
证券代码	证券简称	证券代码	证券简称	证券代码	证券简称	603986.SH	兆易创新	300373.SZ	扬杰科技	688008.SH	澜起科技
002475.SZ	立讯精密	002273.SZ	水晶光电	000050.SZ	深天马A	688008.SH	澜起科技	300623.SZ	捷捷微电	688795.SH	摩尔线程
002179.SZ	中航光电	002036.SZ	联创电子	688055.SH	龙腾光电	300475.SZ	香农芯创	600360.SH	华微电子	688802.SH	沐曦股份
002025.SZ	航天电器	688048.SH	长光华芯	300088.SZ	长信科技	301308.SZ	江波龙	600460.SH	士兰微	688041.SH	海光信息
300679.SZ	电连技术	688167.SH	炬光科技	003019.SZ	宸展光电	688525.SH	佰维存储	603290.SH	斯达半导	688256.SH	寒武纪
688800.SH	瑞可达	603297.SH	永新光学	300939.SZ	秋田微	001309.SZ	德明利	605111.SH	新洁能	688521.SH	芯原股份
605333.SH	沪光股份	300790.SZ	宇瞳光学	300928.SZ	华安鑫创	688825.SH	长鑫科技	688187.SH	时代电气		
605005.SH	合兴股份	002222.SZ	福晶科技	300752.SZ	隆利科技			688261.SH	东微半导		
002055.SZ	得润电子	688127.SH	蓝特光学	605218.SH	伟时电子			688396.SH	华润微		
688668.SH	鼎通科技	605118.SH	力鼎光电								
002897.SZ	意华股份	688079.SH	美迪凯								
300351.SZ	永贵电器	300552.SZ	万集科技								
300843.SZ	胜蓝股份	688010.SH	福光股份								
603633.SH	徕木股份	300691.SZ	联合光电								
		688195.SH	腾景科技								

来源：国金证券研究所

2.1：半导体：上游自主化加速，存储需求高增，设备与设计表现较好

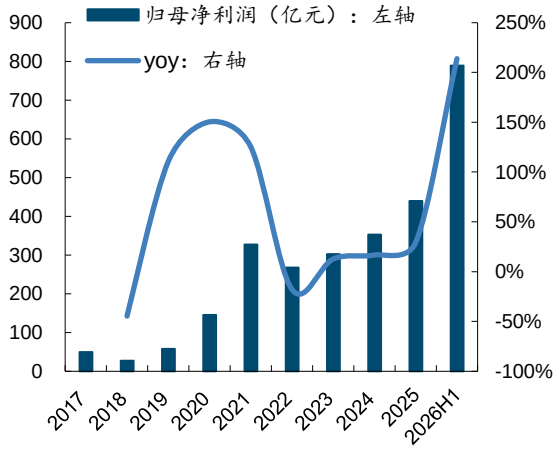
整体来看，根据申万二级行业分类，半导体行业 2026H1 实现营收 4297.38 亿元，同增 28.59%，归母净利润 789.13 亿元，同增 213.62%。其中，2026Q2 实现营收 2628.25 亿元，同增 38.10%，归母净利润 557.57 亿元，同增 243.08%。上半年国内先进逻辑及先进存储产能持续扩张，先进制程良率稳步改善，叠加先进封装能力持续提升，国产 AI 芯片供应链瓶颈进一步缓解。同时，国内晶圆厂资本开支维持较高强度，核心产线建设持续推进，带动半导体设备及零部件国产替代加速。存储价格上行与行业景气修复推动相关设计公司盈利弹性持续释放；此外，国内大模型迭代及多模态应用加速落地，云端算力需求保持高景气，国产 AI 算力芯片及配套硬件规模化导入提速。受益于存储周期上行、AI 算力放量及国产替代共振，半导体板块利润增速显著高于收入增速，盈利能力明显改善。

图表6：半导体行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

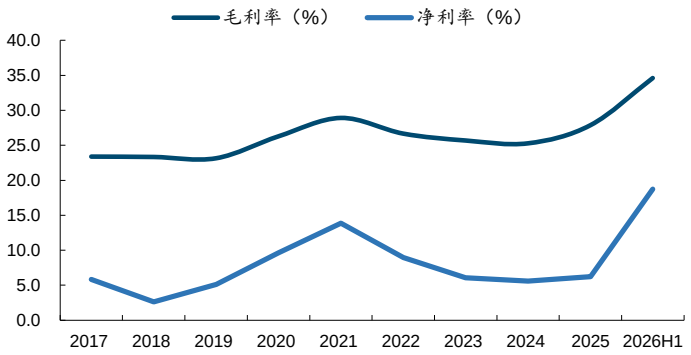
图表7：半导体行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

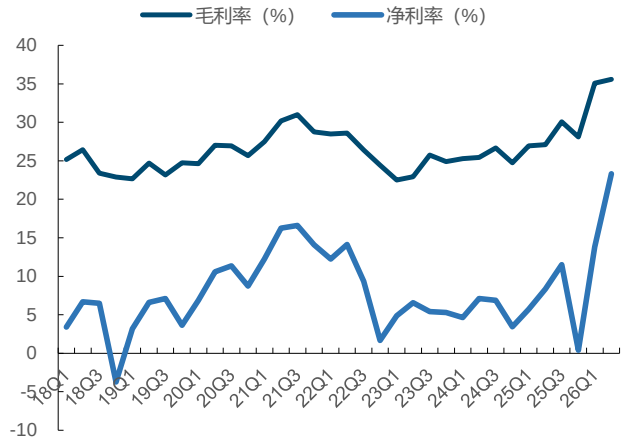
半导体行业 26Q2 盈利能力进一步改善。26Q2 毛利率为 35.6%，同比+8.5pct，环比+0.5pct；净利率为 23.3%，同比+15.0pct，环比+9.5pct。

图表8：半导体行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表9：半导体行业单季度历史盈利能力情况

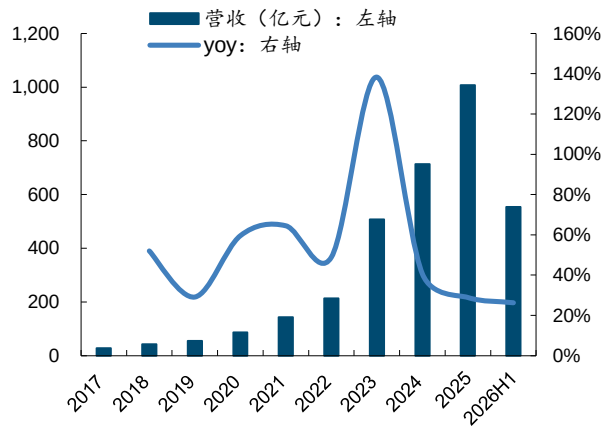


来源：wind、国金证券研究所

中美贸易摩擦与外部技术封锁常态化背景下，半导体设备及零部件国产替代持续推进。国内晶圆厂资本开支维持较高强度，先进逻辑及存储产线扩产持续落地，叠加工艺升级带来的设备价值量提升，国产设备厂商订单及收入保持较快增长。后续随着国内先进制程、先进存储持续扩产，以及关键设备国产化率进一步提升，半导体设备板块有望继续受益。

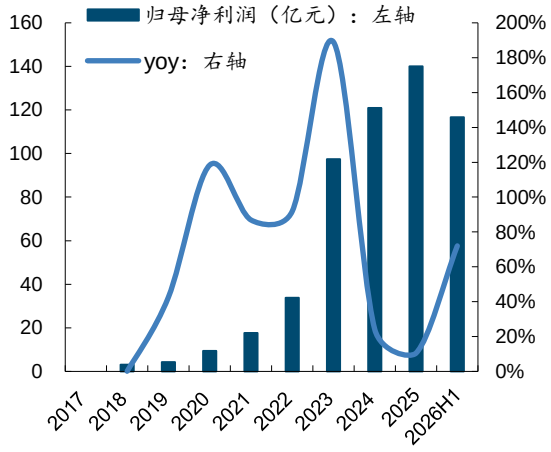
半导体设备行业 2026H1 实现营收 553.73 亿元，同增 26.33%，归母净利润 116.64 亿元，同增 71.94%，利润增速显著高于收入增速。其中，2026Q2 实现营收 298.75 亿元，同增 42.01%，归母净利润 72.19 亿元，同增 92.94%。上半年国内晶圆厂扩产及国产替代需求延续，设备厂商收入保持较快增长；同时随着收入规模扩大、产品结构优化及规模效应释放，板块盈利能力进一步提升。

图表10：半导体设备行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

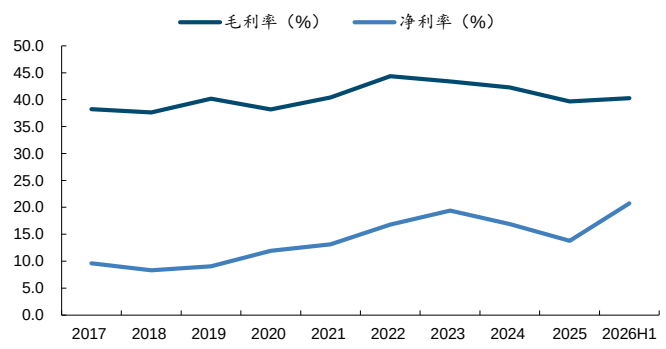
图表11：半导体设备行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

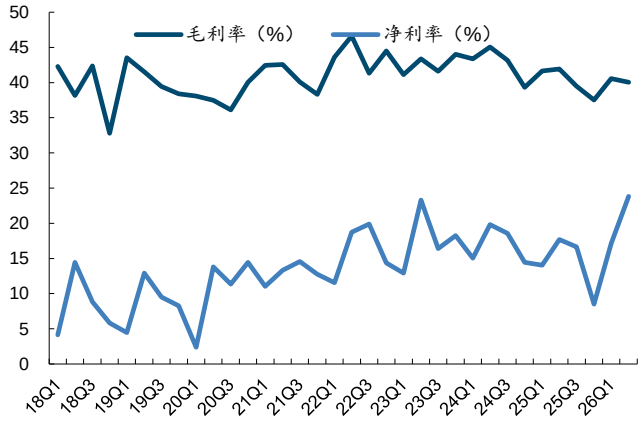
半导体设备行业 2026H1 毛利率为 40.3%，净利率为 20.7%。26Q2 毛利率为 40.1%，同比-1.9pct，环比-0.5pct；净利率为 23.8%，同比+6.1pct，环比+6.7pct。

图表12：半导体设备行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

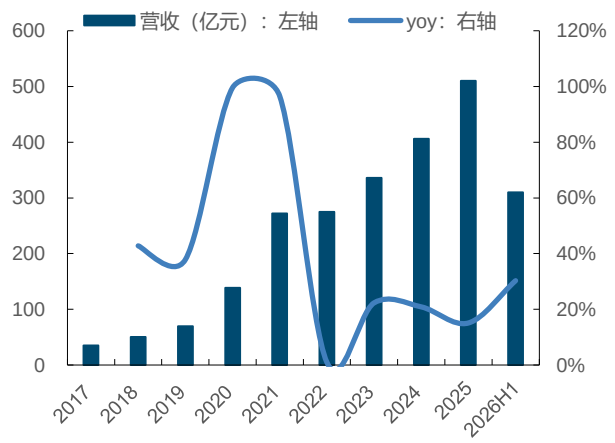
图表13：半导体设备行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

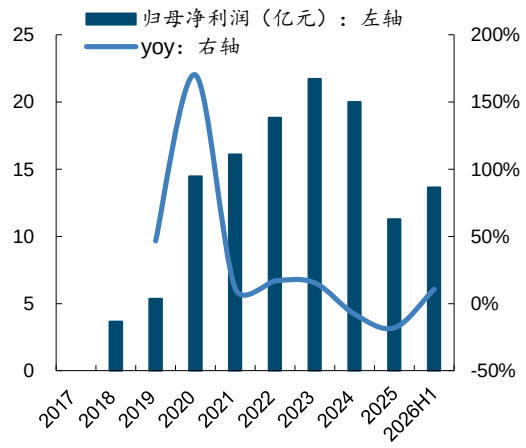
半导体材料行业 2026H1 实现营收 310.01 亿元，同增 30.26%，归母净利润 13.65 亿元，同增 10.63%。其中，2026Q2 实现营收 167.47 亿元，同增 40.37%；归母净利润 9.82 亿元，同增 29.66%。半导体材料行业具有一定后周期属性，需求释放通常滞后于晶圆厂扩产与设备进场。随着国内晶圆厂产能持续爬坡、先进逻辑及存储产线逐步放量，光刻胶、电子特气、湿电子化学品、靶材等材料需求稳步增长。

图表14：半导体材料行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

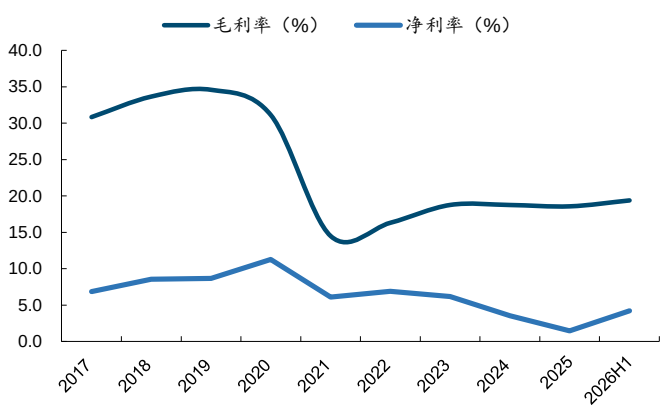
图表15：半导体材料行业历史归母业绩情况



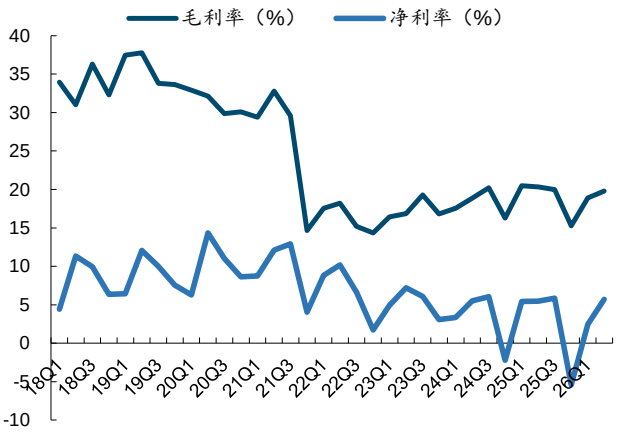
来源：wind、国金证券研究所

半导体材料行业 2026H1 毛利率为 19.4%，净利率为 4.2%。26Q2 毛利率为 19.8%，同比-0.5pct，环比+0.9pct；净利率为 5.7%，同比+0.2pct，环比+3.3pct。

图表16：半导体材料行业历史盈利能力情况



图表17：半导体材料行业单季度历史盈利能力情况

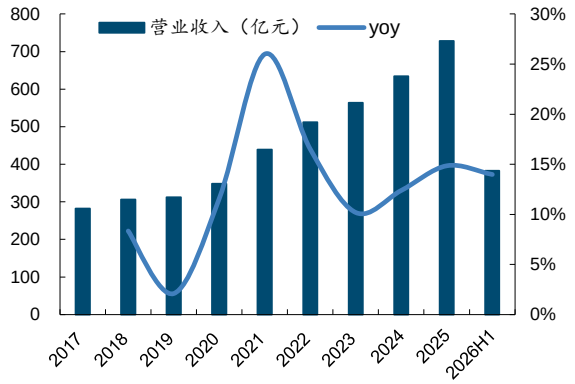


来源：wind、国金证券研究所

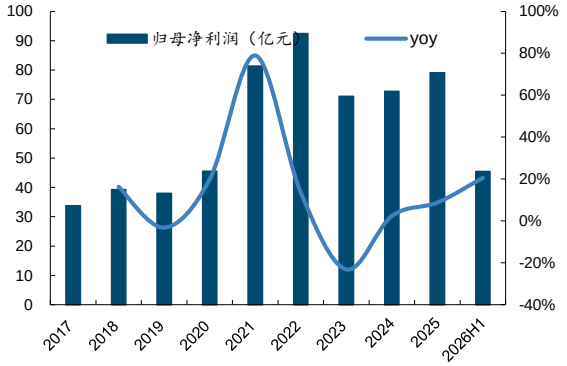
来源：wind、国金证券研究所

功率半导体行业 2026H1 实现营收 382.47 亿元，同增 14.0%，归母净利润 45.42 亿元，同增 20.52%。其中，2026Q2 实现营收 213.93 亿元，同增 12.08%，归母净利润 26.90 亿元，同增 19.76%。在汽车电气化、智能化持续深化的背景下，800V 高压平台渗透率提升，带动 SiC MOSFET 及高性能 IGBT 模块需求持续增长；同时，AI 服务器与数据中心功率密度提升，对高效率、高功率密度电源方案提出更高要求，带动高端 MOSFET、GaN 等功率器件需求扩张。整体来看，行业收入保持稳健增长，利润增速高于收入增速，盈利能力有所改善。

图表18：功率半导体行业历史营收情况



图表19：功率半导体行业历史归母业绩情况

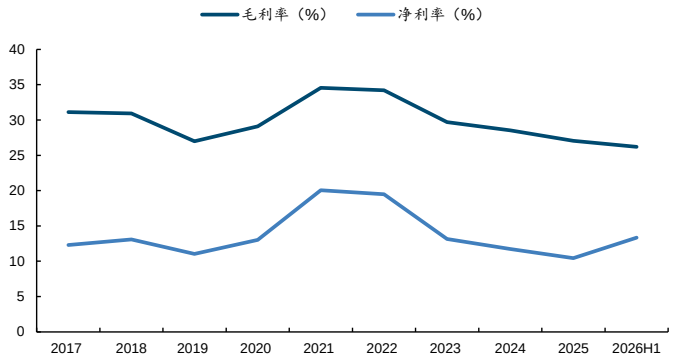


来源：wind、国金证券研究所

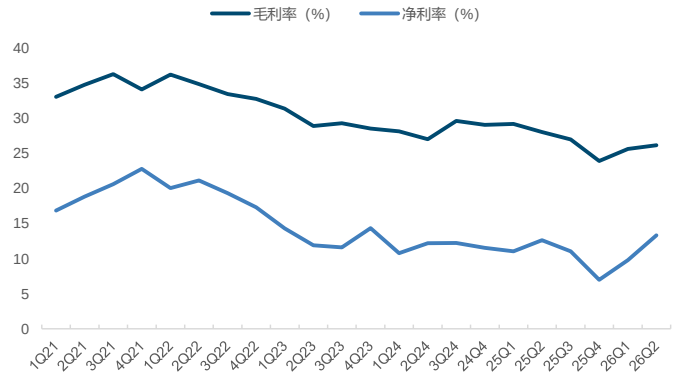
来源：wind、国金证券研究所

功率半导体行业 2026H1 毛利率为 26.0%，净利率为 11.9%。26Q2 毛利率为 26.2%，同比-1.9pct，环比+0.5pct；净利率为 13.3%，同比+0.7pct，环比+3.5pct。

图表20：功率半导体行业历史盈利能力情况



图表21：功率半导体行业单季度历史盈利能力情况

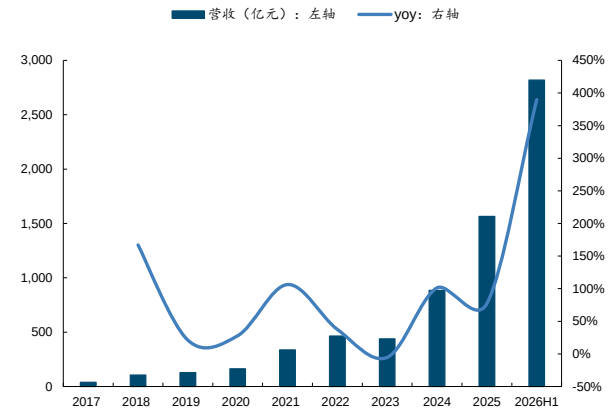


来源：wind、国金证券研究所

来源：wind、国金证券研究所

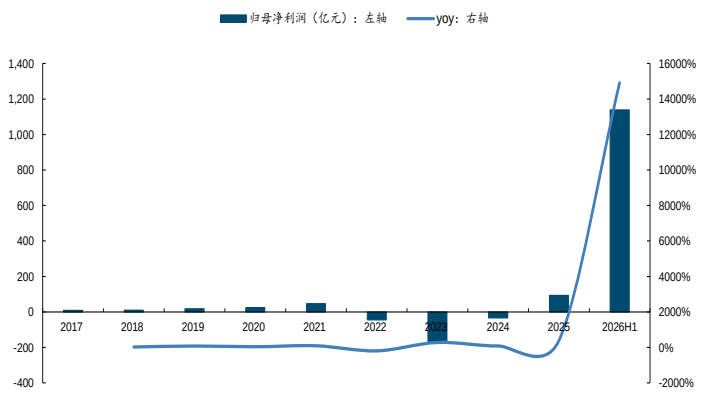
存储行业 2026H1 营收为 2819.90 亿元，同增 389.89%，归母净利润为 1138.60 亿元，同增 14912.95%。其中，2026Q2 实现营收 1775.15 亿元，同增 433.54%，归母净利润 753.55 亿元，同增 17339.65%。大模型迭代与算力集群扩张持续增加对高带宽、大容量存储的需求，带动 HBM 与企业级 SSD（eSSD）需求快速增长；同时海外原厂持续将产能向 HBM 等高附加值产品倾斜，传统 DRAM 与 NAND 供给维持偏紧，存储产品价格保持较高水平。国内存储厂商受益于行业景气上行、前期低价库存释放及产品结构优化，收入与盈利均实现大幅增长，利润弹性显著高于收入增速；同时，随着自主可控持续推进，国产存储模组及主控芯片在服务器、AIPC 及 AI 手机等市场的渗透率逐步提升，行业供需改善与国产替代共同支撑板块业绩高增。

图表22：存储行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

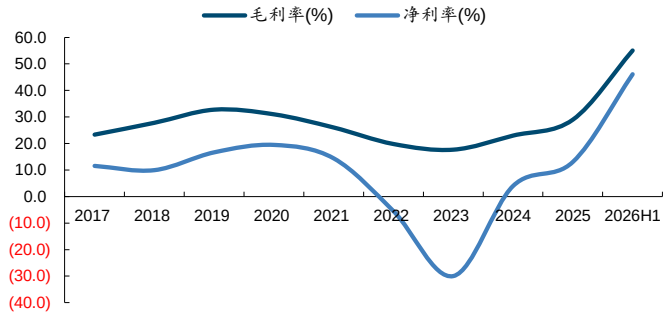
图表23：存储行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

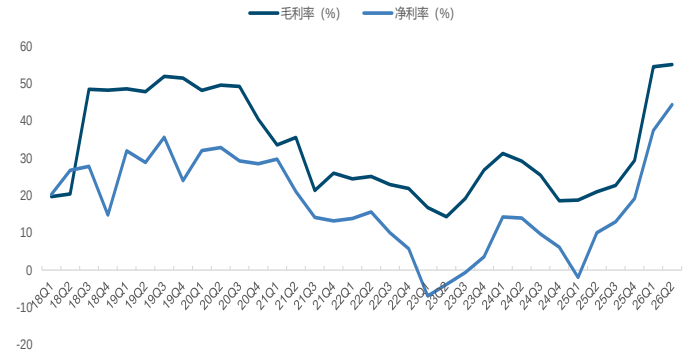
存储行业2026H1毛利率为55.1%，同比+35.0pct，净利率为46.1%，同比+42.9pct。26Q2毛利率为55.0%，同比+34.1pct，环比+0.6pct；净利率为48.7%，同比+42.1pct，环比+7.3pct。

图表24：存储行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

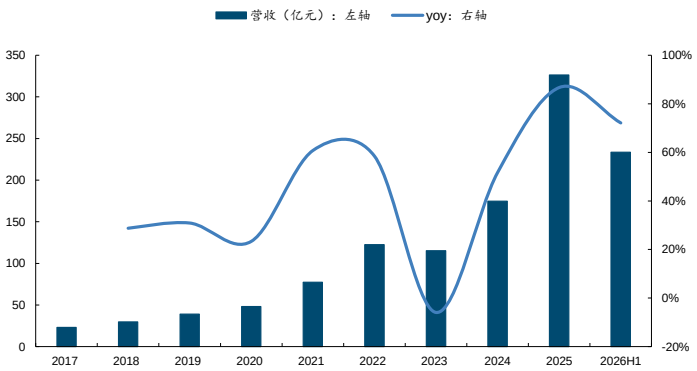
图表25：存储行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

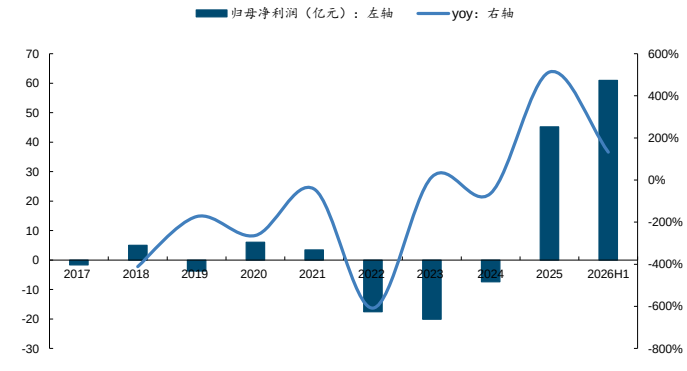
算力芯片行业2026H1营收为233.53亿元，同增72.11%，归母净利润为60.96亿元，同增132.48%。其中，2026Q2实现营收128.39亿元，同增63.85%，归母净利润39.58亿元，同增119.83%。随着国内大模型持续迭代，算力需求由训练向推理侧加速延伸，叠加互联网、运营商及政企客户对国产算力基础设施投入增加，带动国产GPU、ASIC等算力芯片出货规模持续提升。在供应链安全与自主可控驱动下，国产算力芯片的产品验证、生态适配及客户导入不断推进，头部厂商逐步进入规模化放量阶段。利润端增速显著高于收入增速，主要受益于产品出货扩大带来的规模效应、前期研发投入逐步转化为收入，以及高端算力芯片占比提升带来的产品结构优化，板块盈利能力进一步改善。

图表26：算力芯片行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

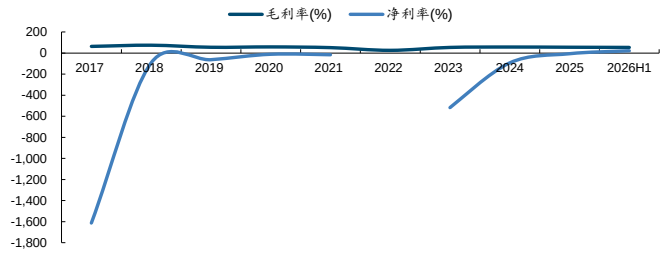
图表27：算力芯片行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

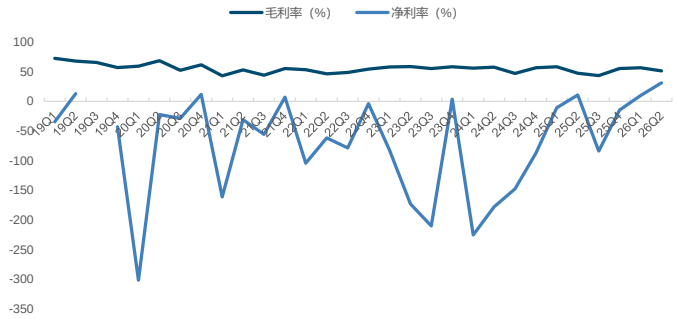
算力芯片行业 2026H1 毛利率为 53.5%，同比+5.4pct，净利率为 22.0%，同比+19.3pct。26Q2 毛利率为 51.3%，同比+3.8pct，环比-5.3pct；净利率为 31.2%，同比+20.5pct，环比+21.3pct。

图表28：算力芯片行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

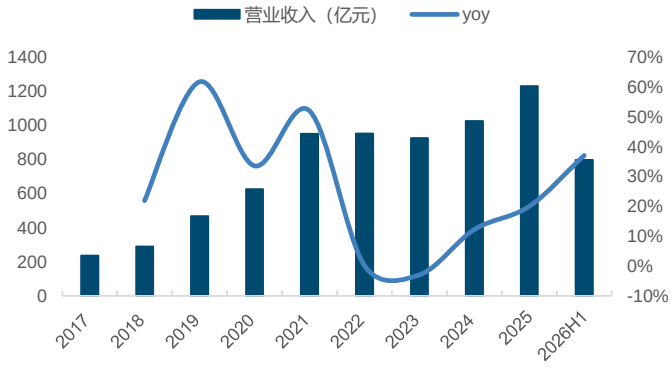
图表29：算力芯片行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

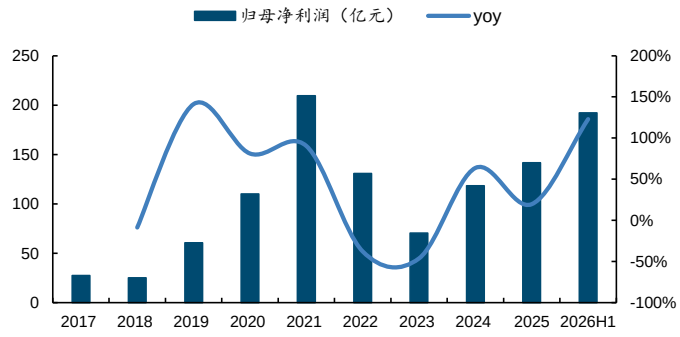
半导体设计板块 2026H1 实现营收 797.23 亿元，同比增长 37.13%，实现归母净利润 192.23 亿元，同比增长 123.09%。其中，2026Q2 实现营收 451.89 亿元，同增 41.05%，归母净利润 132.79 亿元，同增 157.38%。人工智能与云计算基础设施持续扩张，叠加端侧 AI 加速渗透，推动半导体设计行业需求保持高景气。存储价格上行带来的盈利弹性持续释放，AI 算力需求增长则推动高性能计算芯片及配套芯片加速放量；同时，AI 手机、AIPC 及智能眼镜等端侧 AI 硬件持续升级，带动高性能 SoC、大容量存储、高阶 CIS 及电源管理芯片需求增长。受益于存储涨价、AI 算力放量及产品结构优化，板块利润增速显著高于收入增速，盈利能力明显提升。

图表30：半导体设计行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

图表31：半导体设计行业历史归母业绩情况

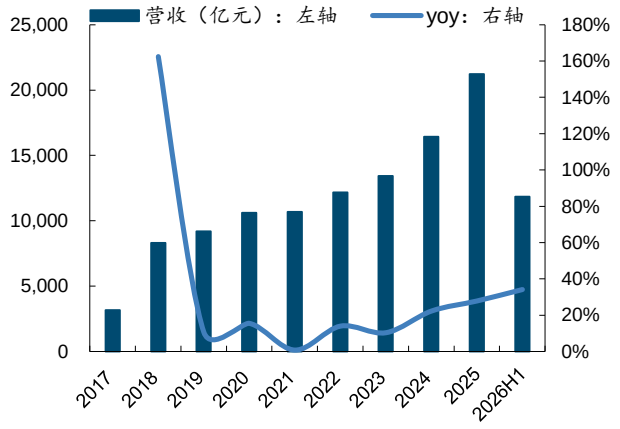


来源：wind、国金证券研究所

2.2：消费电子：2026H1 营收同增 34.11%，归母净利同增 50.96%

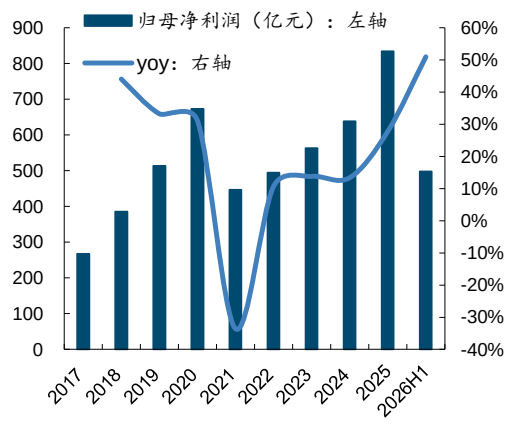
消费电子行业 2026H1 实现营收 11845.03 亿元，同增 34.11%，归母净利润 497.80 亿元，同增 50.96%。其中，2026Q2 实现营收 6432.60 亿元，同增 34.46%，归母净利润 287.77 亿元，同增 55.13%。上半年端侧 AI 持续推动智能手机、AIPC 及可穿戴设备软硬件升级，叠加新品周期带动换机需求改善，消费电子产业链景气度延续。同时，部分消费电子龙头加速向 AI 服务器、液冷散热、高速连接及精密结构件等新兴领域拓展，原有精密制造与供应链管理能力逐步向算力硬件环节复用。

图表32：消费电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

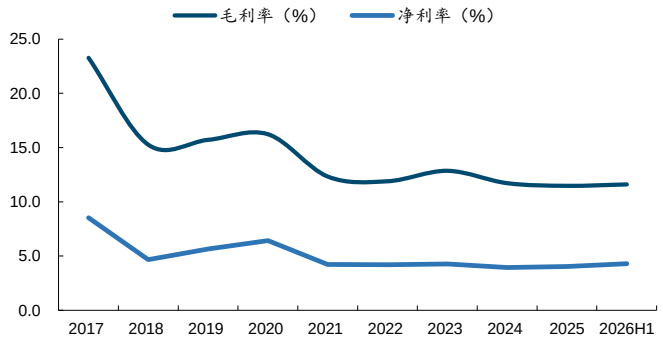
图表33：消费电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

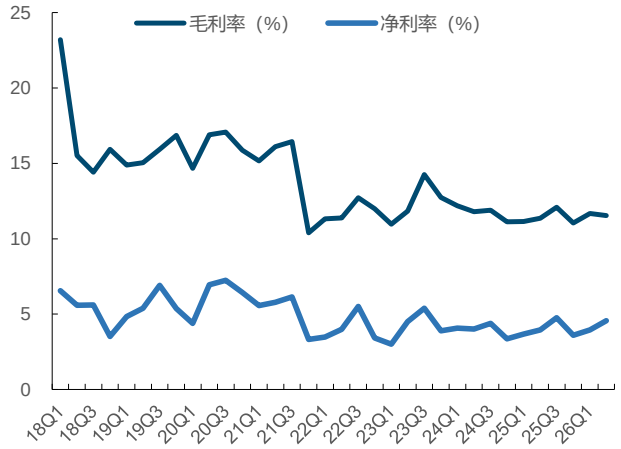
消费电子行业盈利能力保持稳定。2026H1 毛利率为 11.6%，净利率为 4.3%。26Q2 毛利率为 11.5%，同比-0.3pct，环比-0.1pct；净利率为 4.6%，同比+0.6pct，环比+0.6pct。

图表34：消费电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表35：消费电子行业单季度历史盈利能力情况

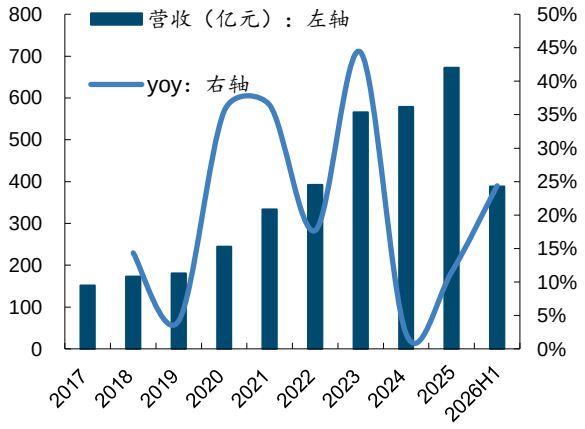


来源：wind、国金证券研究所

2.3：电子化学品：2026H1 营收同增 24.36%，26H1 归母净利同增 14.24%

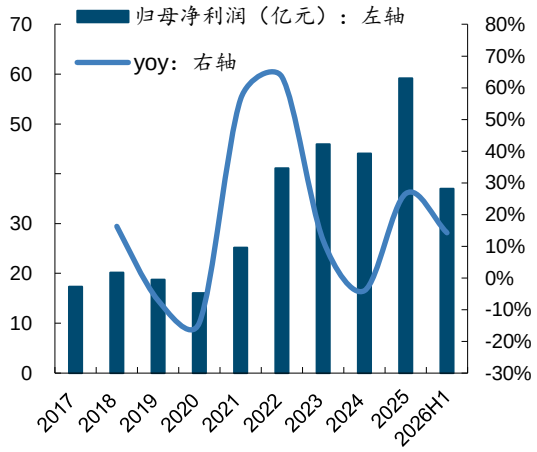
电子化学品行业 2026H1 实现营收 388.25 亿元，同增 24.36%，归母净利润 36.98 亿元，同增 14.24%。其中，2026Q2 实现营收 209.73 亿元，同增 30.45%，归母净利润 20.31 亿元，同增 26.69%。随着国内晶圆厂扩产及产能利用率提升，湿电子化学品、电子特气、光刻胶及配套材料需求持续增长，叠加国产替代推进，板块收入保持较快增长。

图表36：电子化学品行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

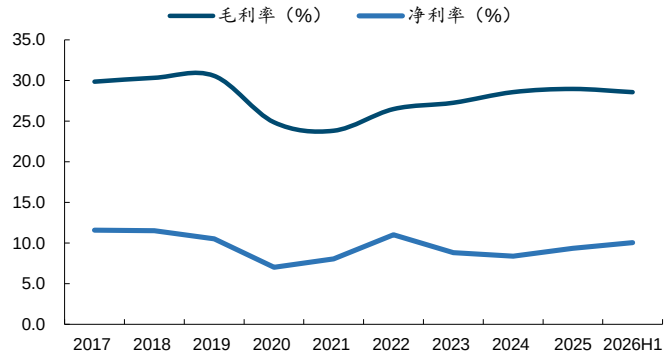
图表37：电子化学品行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

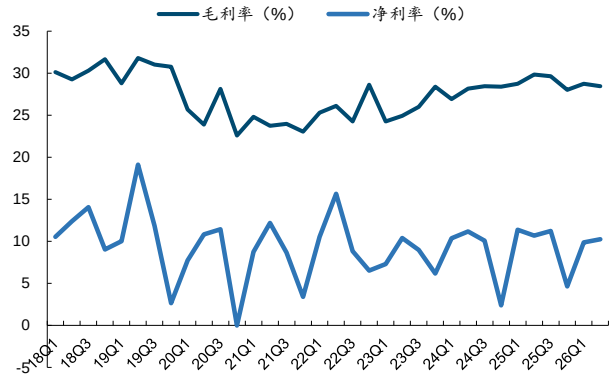
盈利能力保持稳定。电子化学品行业 2026H1 毛利率为 28.6%，净利率为 10.1%。26Q2 毛利率为 28.4%，同比-1.4pct，环比-0.3pct；净利率为 10.2%，同比-0.4pct，环比+0.4pct。

图表38：电子化学品行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表39：电子化学品行业单季度历史盈利能力情况

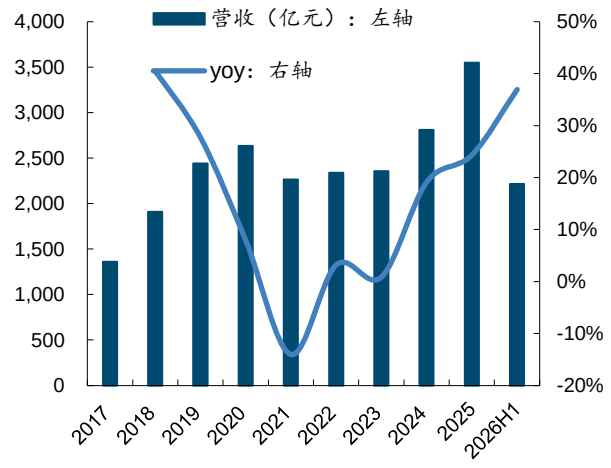


来源：wind、国金证券研究所

2.4：元件：PCB 2026H1 营收同增 36.48%，26H1 归母净利同增 72.66%

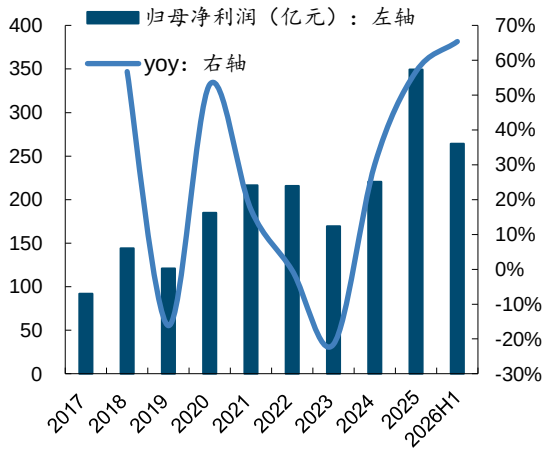
元件行业 2026H1 实现营收 2214.43 亿元，同增 36.95%，归母净利润 264.09 亿元，同增 65.40%。其中，2026Q2 实现营收 1235.12 亿元，同增 47.00%，归母净利润 164.10 亿元，同增 84.99%。上半年 AI 服务器、高速互联及高端算力硬件需求保持高景气，带动 PCB、连接器、被动元件等细分环节需求持续增长；同时汽车电子及消费电子需求改善，也对板块形成一定支撑。

图表40：元件行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

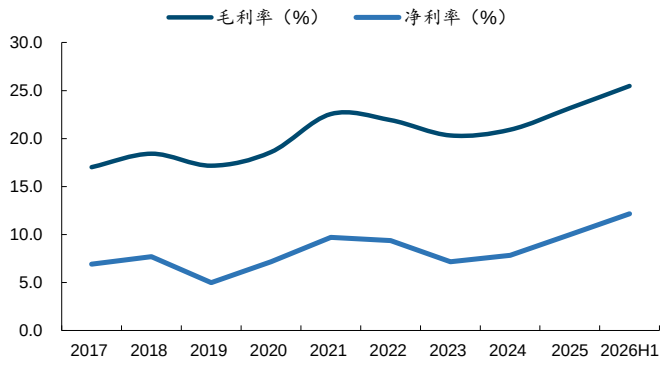
图表41：元件行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

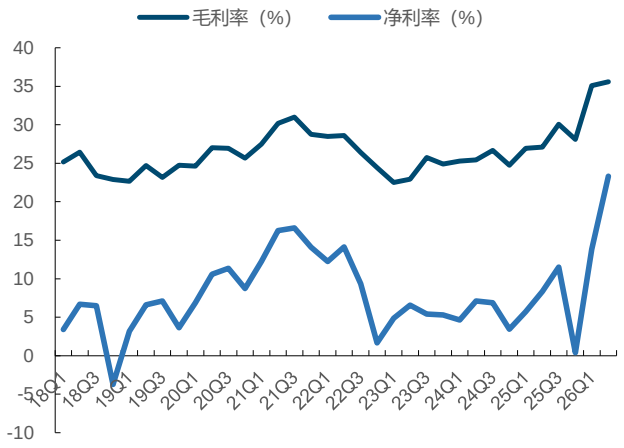
盈利能力持续改善。元件行业 2026H1 毛利率为 25.5%，净利率为 12.1%。26Q2 毛利率为 26.4%，同比+2.8pct，环比+2.0pct；净利率为 13.5%，同比+2.8pct，环比+3.1pct。

图表42：元件行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

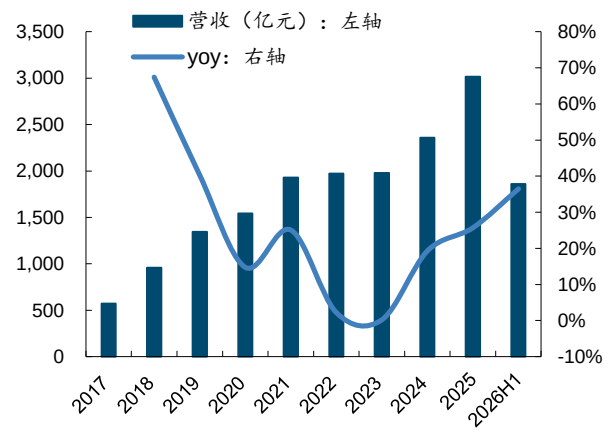
图表43：元件行业单季度历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

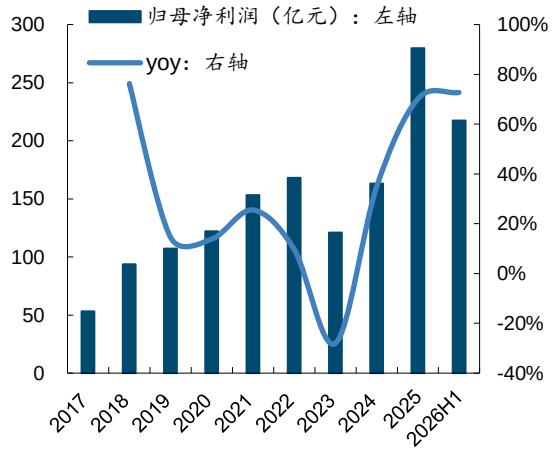
PCB 行业 2026H1 实现营收 1861.21 亿元，同增 36.48%，归母净利润 217.38 亿元，同增 72.66%。其中，2026Q2 实现营收 1035.87 亿元，同增 47.45%，归母净利润 137.24 亿元，同增 95.67%。受全球 AI 算力基础设施持续高景气驱动，AI 服务器、交换机及高速互联相关 PCB 需求快速增长，高多层板、高阶 HDI 及低损耗材料需求持续放量。随着新一代 GPU 平台及北美云厂商 ASIC 方案进入规模化部署阶段，单机柜 PCB 用量与价值量继续提升，头部厂商高端产能保持较高稼动率。同时，封装基板需求随半导体景气回升逐步改善。

图表44：PCB行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

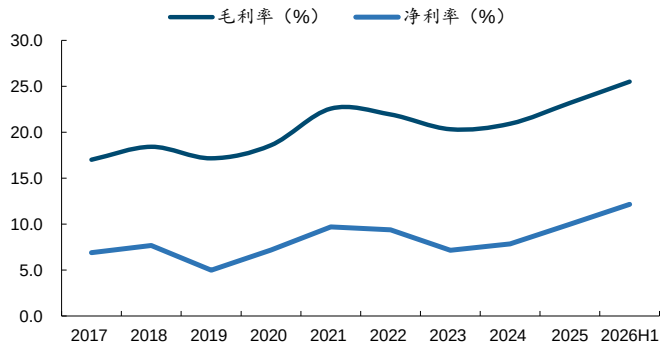
图表45：PCB行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

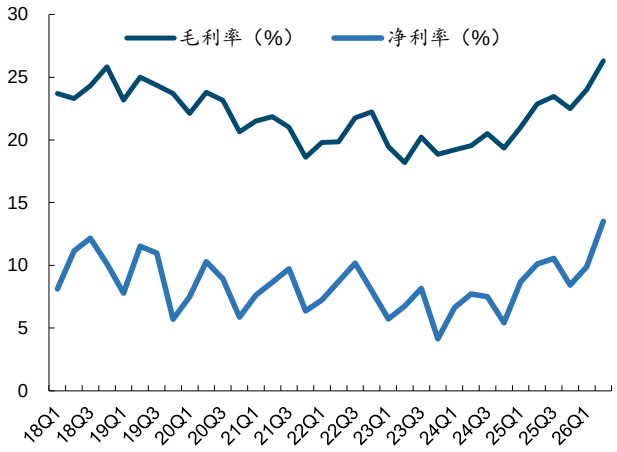
PCB行业2026H1毛利率为25.3%，净利率为11.9%。26Q2毛利率为26.3%，同比+3.4pct，环比+2.3pct；净利率为13.5%，同比+3.4pct，环比+3.6pct。

图表46：PCB行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表47：PCB行业单季度历史盈利能力情况

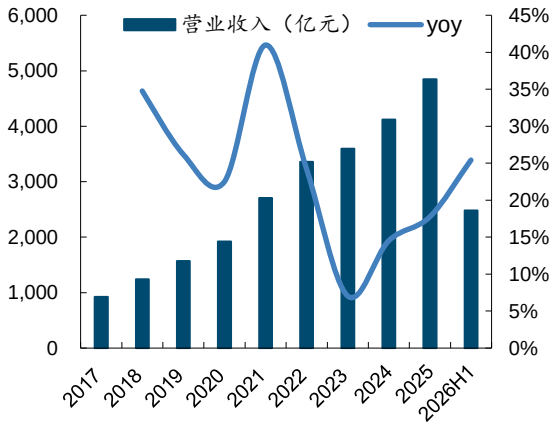


来源：wind、国金证券研究所

2.5：汽车电子：2026H1营收同增25.43%，26H1归母净利下降7.10%

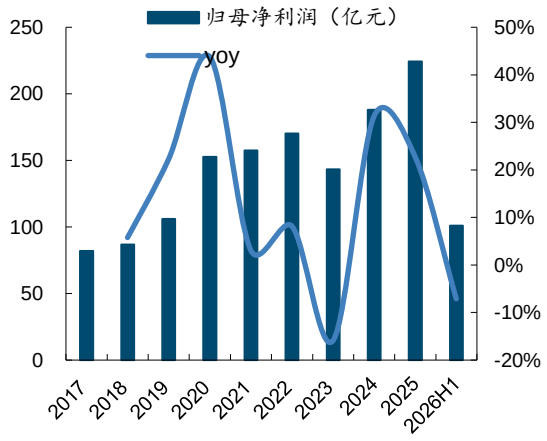
汽车电子板块2026H1实现营收2480.85亿元，同增25.43%，归母净利润100.93亿元，同比-7.10%。其中，2026Q2实现营收1300.88亿元，同增27.59%，归母净利润53.50亿元，同减11.05%。随着新能源汽车行业由高速增长逐步转向稳健增长，汽车电子需求增速有所分化，但800V高压平台、快充、智能驾驶及座舱电子渗透率持续提升，仍带动功率器件、连接器、传感器及控制器等环节需求增长。上半年板块收入保持较快增长，但受价格竞争、部分环节降价压力及成本端扰动影响，利润端承压，盈利增速弱于收入增速。

图表48：汽车电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

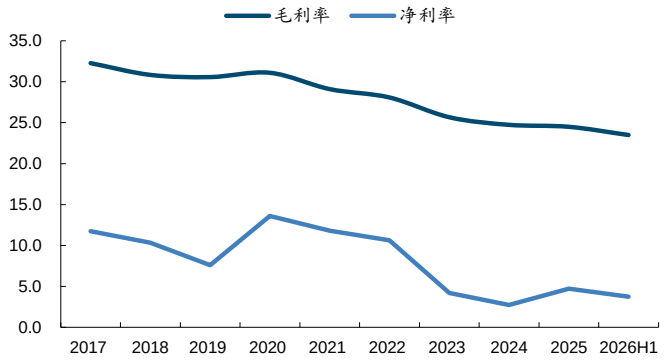
图表49：汽车电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

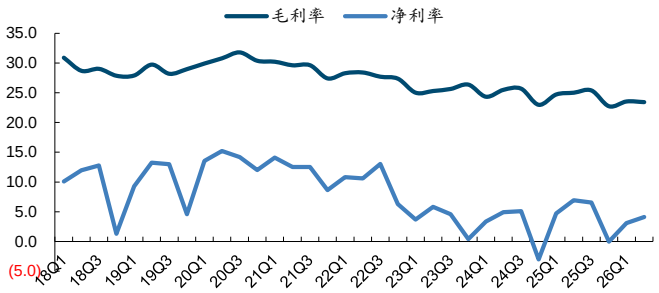
盈利能力有所承压。汽车电子行业 2026H1 毛利率为 23.5%，净利率为 3.7%。26Q2 毛利率为 23.4%，同比-1.6pct，环比-0.1pct；净利率为 4.1%，同比-2.8pct，环比+1.0pct。

图表50：汽车电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表51：汽车电子行业单季度历史盈利能力情况

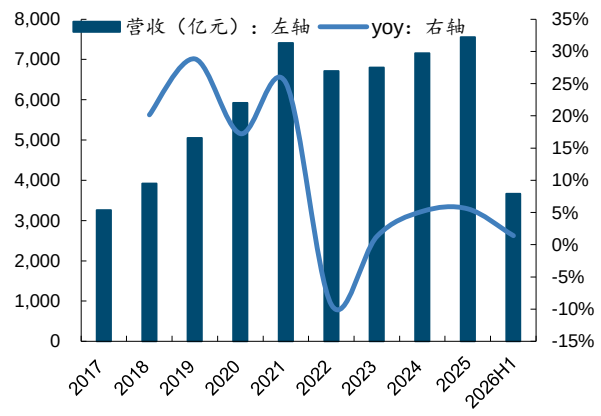


来源：wind、国金证券研究所

2.6：光学光电子：2026H1 营收同增 1.41%，26H1 归母净利增加 18.67%

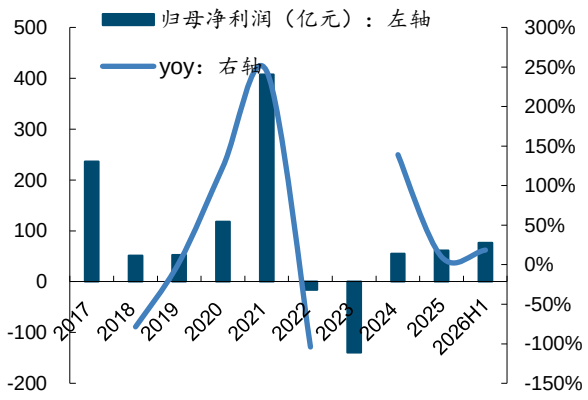
光学光电子行业 2026H1 实现营收 3668.85 亿元，同增 1.41%，归母净利润 76.40 亿元，同增 18.67%。其中，2026Q2 实现营收 1903.19 亿元，同增 0.64%，归母净利润 48.90 亿元，同增 56.07%。上半年板块收入整体增长较为平稳，主要受显示面板、LED 及传统光学业务需求相对稳定影响；同时，AI 服务器高速光模块、光通信器件及部分高端光学产品需求增长，对板块利润端形成支撑。

图表52：光学光电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

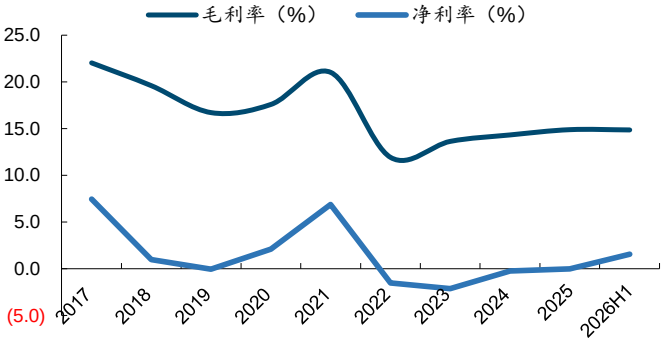
图表53：光学光电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

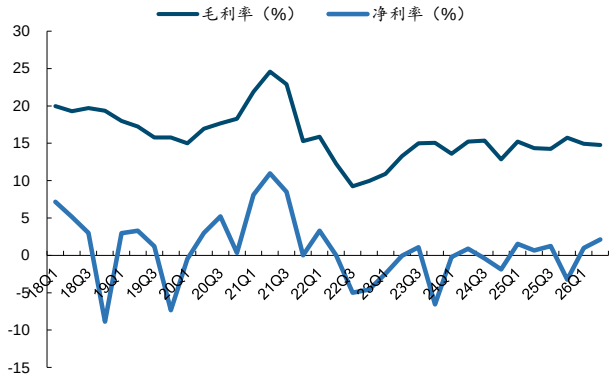
盈利能力改善。光学光电子行业 2026H1 毛利率为 14.9%，净利率为 1.6%。26Q2 毛利率为 14.8%，同比+0.4pct，环比-0.2pct；净利率为 2.1%，同比+1.5pct，环比+1.1pct。

图表54：光学光电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表55：光学光电子行业单季度历史盈利能力情况

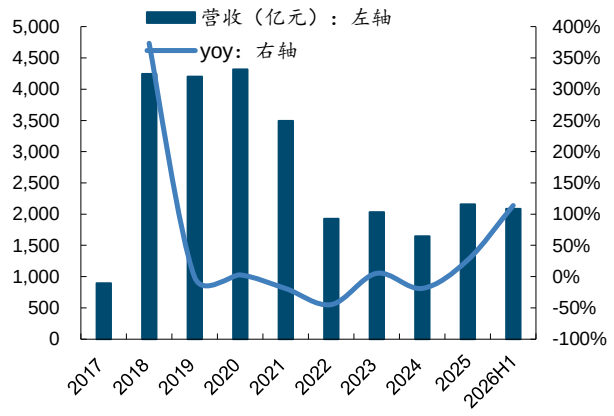


来源：wind、国金证券研究所

2.7：其他电子：2026H1 营收同增 113.77%，26H1 归母净利同增 154.99%

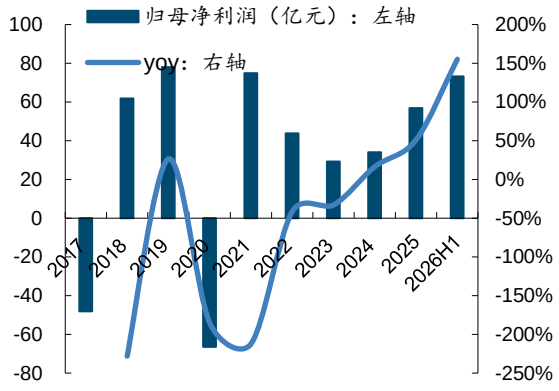
其他电子行业 2026H1 实现营收 2083.28 亿元，同增 113.77%，归母净利润 73.21 亿元，同增 154.99%。其中，2026Q2 实现营收 1220.95 亿元，同增 129.88%，归母净利润 44.29 亿元，同增 179.14%。上半年板块收入与利润均实现高速增长，主要受部分高景气细分方向放量及低基数影响。随着 AI 硬件、精密制造及相关新兴电子应用需求增长，板块景气度明显改善。

图表56：其他电子行业历史营收情况



来源：wind、国金证券研究所

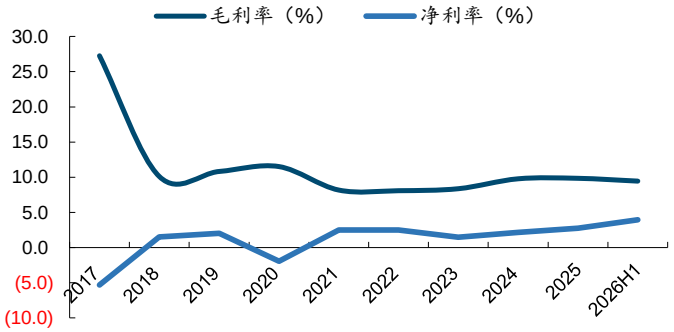
图表57：其他电子行业历史归母业绩情况



来源：wind、国金证券研究所

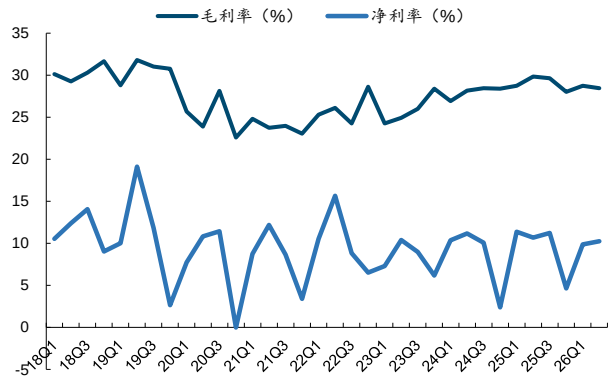
盈利能力持续改善。其他电子行业 2026H1 毛利率为 9.4%，净利率为 3.9%。26Q2 毛利率为 9.8%，同比+0.1pct，环比+0.8pct；净利率为 4.3%，同比+1.3pct，环比+0.9pct。

图表58：其他电子行业历史盈利能力情况



来源：wind、国金证券研究所

图表59：其他电子行业单季度历史盈利能力情况



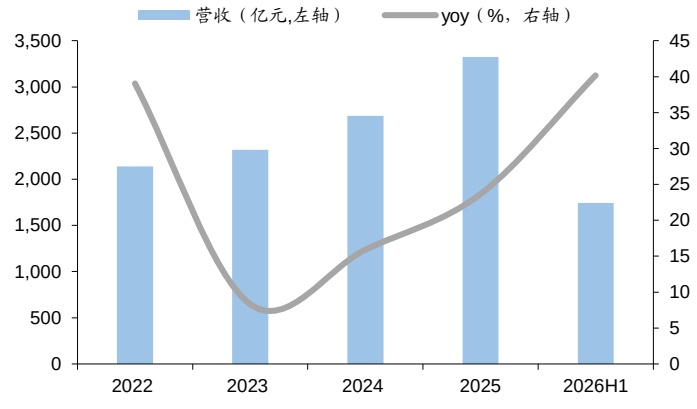
来源：wind、国金证券研究所

三、龙头表现：AI 硬件产业链公司业绩亮眼

3.1：消费电子

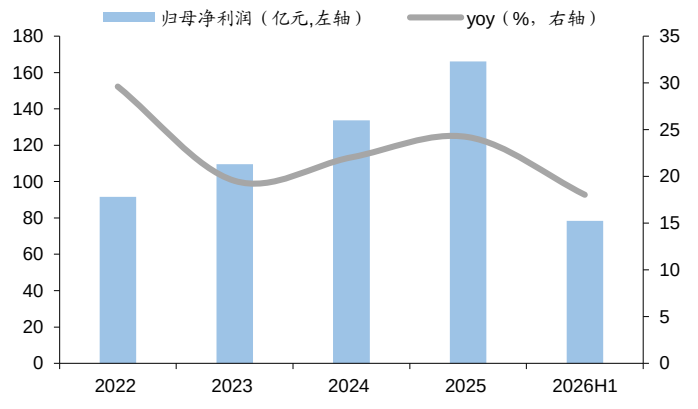
立讯精密：2026H1 公司实现营业收入 1745.04 亿元，同比+40.16%；归母净利润 78.43 亿元，同比+18.04%；扣非归母净利润 59.62 亿元，同比+6.47%。其中 w，2026Q2 实现营业收入 906.16 亿元，同比+44.49%；归母净利润 41.83 亿元，同比+16.17%。作为全球精密智造龙头，2026 年上半年公司三大业务板块协同推进，消费电子持续推动核心客户新品及 ODM/JDM 项目导入，营收同比+19.27%；通信与数据中心围绕"铜、光、电、热"一体化解决方案加快业务落地，上半年 800G 产品已实现量产出货，营收实现同比+49.66%；汽车电子业务方面，公司为全球车企以及中国汽车品牌出海提供本地化、智能化配套服务，持续推进 Leoni 整合与全球客户拓展，上半年营收同比+274.10%。整体来看，公司营收保持较快增长，Q2 收入增速进一步提升，多元业务布局与全球化交付能力持续夯实中长期成长基础。

图表60：立讯精密营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

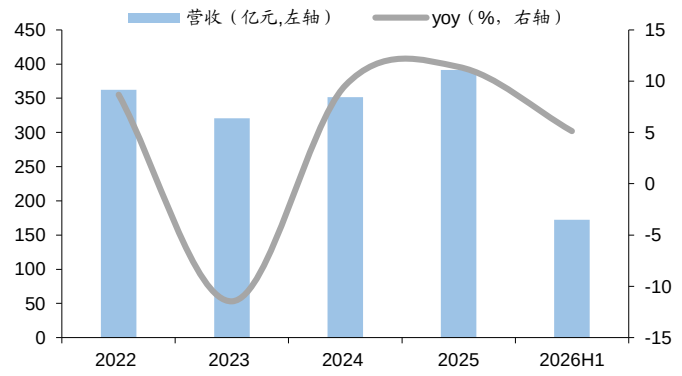
图表61：立讯精密归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

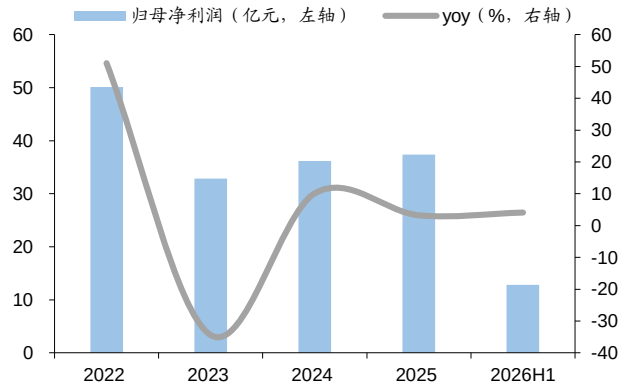
鹏鼎控股：2026H1 公司实现营业收入 172.17 亿元，同比+5.14%；归母净利润 12.84 亿元，同比+4.11%；扣非归母净利润 8.92 亿元，同比-22.31%。其中，2026Q2 实现营业收入 92.31 亿元，同比+11.38%；归母净利润 8.21 亿元，同比+10.21%。公司作为全球 PCB 龙头及消费电子柔性电路板（FPC）领先厂商，依托全品类 PCB 平台覆盖 AI“云—管—端”应用场景。上半年通讯用板、消费电子及计算机用板需求仍有压力，汽车与服务器用板收入同比+181.58%，AI 服务器及光模块业务快速增长，受益高算力、高密度布线需求升级；同时持续推进淮安园区扩建与泰国基地量产。整体来看，公司 Q2 收入及利润增速较 Q1 回升，高端产品结构优化带动盈利能力改善，但汇兑损失和研发投入使扣非利润阶段性承压，后续关注 AI 业务放量及海外产能爬坡。

图表62：鹏鼎控股营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

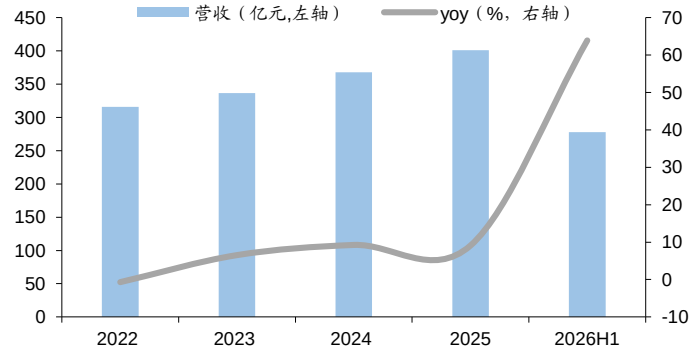
图表63：鹏鼎控股归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

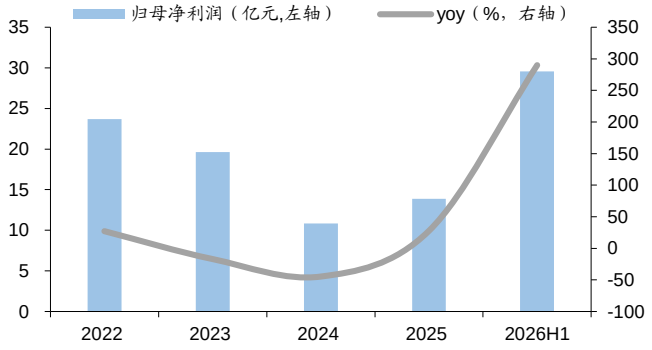
东山精密：2026H1 公司实现营业收入 277.98 亿元，同比+63.95%；归母净利润 29.57 亿元，同比+290.09%；扣非归母净利润 24.80 亿元，同比+277.52%。其中，2026Q2 实现营业收入 146.60 亿元，同比+75.51%；归母净利润 18.47 亿元，同比+511.30%。作为消费电子、PCB 及汽车零部件平台型厂商，公司电子电路业务保持稳健增长，法国 GMD 集团并表及新能源汽车零部件放量推动精密组件业务明显扩张，2026H1 精密组件业务营收同比+178.63%；索尔思光电并表叠加 AI 数据中心需求旺盛，光模块业务成为新的高毛利增长极。整体来看，公司 Q2 收入和盈利进一步提速，AI PCB 与光模块形成核心增量，但后续仍需关注并购整合、财务费用及新增业务盈利稳定性。

图表64：东山精密营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

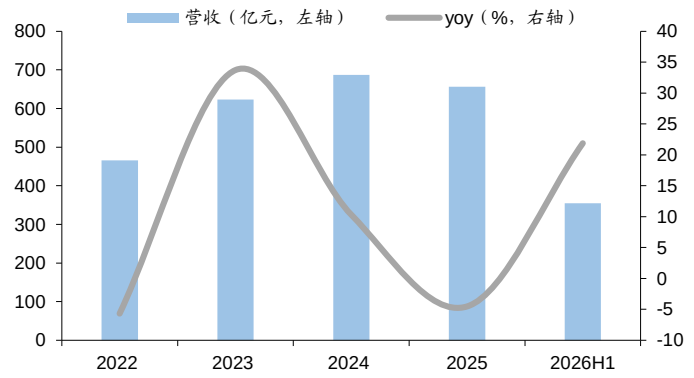
图表65：东山精密归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

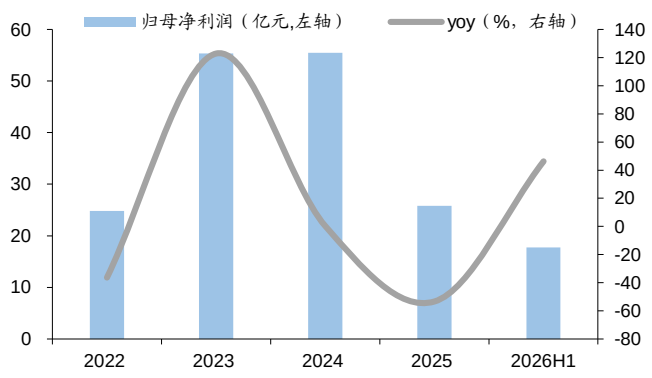
传音控股：2026H1 公司实现营业收入 354.31 亿元，同比+21.85%；归母净利润 17.73 亿元，同比+46.22%；扣非归母净利润 14.80 亿元，同比+64.98%。其中，2026Q2 实现营业收入 192.31 亿元，同比+19.65%；归母净利润 10.73 亿元，同比+48.47%。作为新兴市场手机龙头，公司手机业务出货端有所承压，但中高端产品占比提升及动态调价带动 ASP 上行，盈利能力持续改善；同时继续拓展物联网、储能及移动互联网业务，依托既有品牌和渠道向多品类生态延伸。整体来看，公司 H1 毛利率明显修复，利润增速快于收入，2026 年全年较 2025 年有望延续修复趋势，后续重点关注存储成本上涨后的价格传导、终端销量及新兴市场份额变化。

图表66：传音控股营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

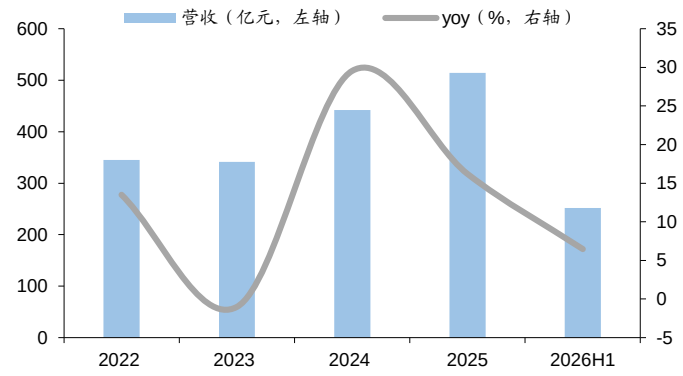
图表67：传音控股归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

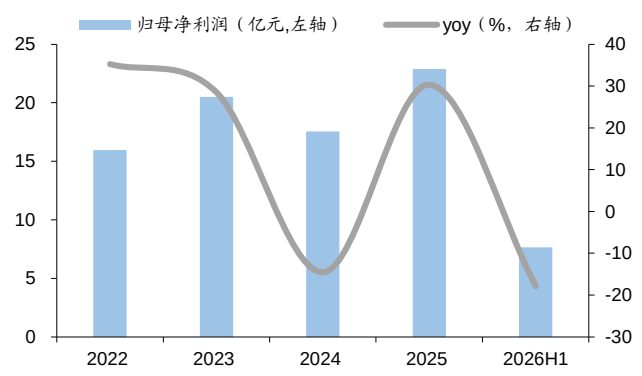
领益智造：2026H1 公司实现营业收入 251.49 亿元，同比+6.45%；归母净利润 7.64 亿元，同比-17.88%；扣非归母净利润 3.89 亿元，同比-35.83%。其中，2026Q2 实现营业收入 125.06 亿元，同比+3.09%；归母净利润 3.72 亿元，同比+2.00%。公司以 AI 硬件业务为核心基本盘，持续加码 AI 终端高附加值产品，并积极布局[illegible]方向，热管理业务保持较快增长；汽车及低空经济板块延续高景气，上半年收入[illegible]，成为重要增量。随着产品结构优化及产线效率提升，公司毛利率同比提升 1.65pct，但研发投入和汇率波动仍对扣非利润形成压力。整体来看，公司上半年营收保持稳步增长，Q2 归母净利润恢复正增长，AI 硬件基本盘稳固叠加汽车、液冷等新业务逐步放量，后续盈利仍具修复空间。

图表68：领益智造营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

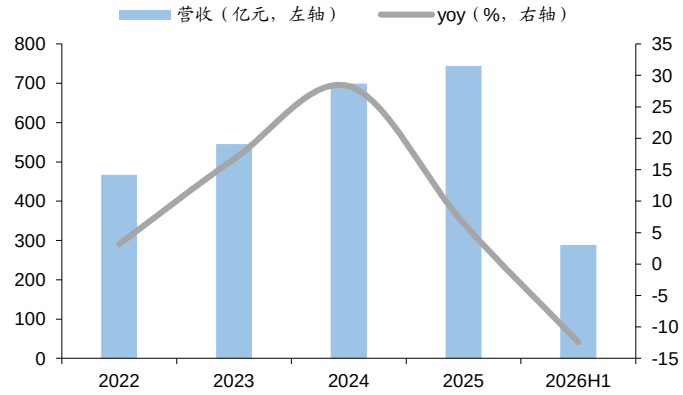
图表69：领益智造归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

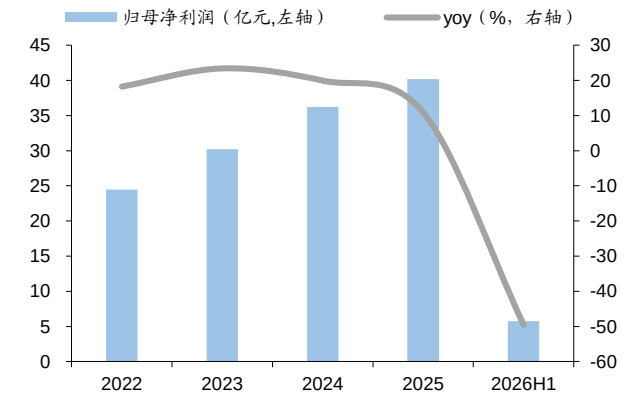
蓝思科技：2026H1 公司实现营业收入 288.66 亿元，同比-12.42%；归母净利润 5.77 亿元，同比-49.52%；扣非归母净利润 2.78 亿元，同比-70.45%。其中，2026Q2 实现营业收入 147.27 亿元，同比-7.36%；归母净利润 7.26 亿元，同比+1.77%。公司以消费电子核心结构件和组装业务为基本盘，上半年受部分终端需求及组装业务调整影响收入承压，但产品结构优化、良率提升及成本管控推动毛利率同比提升 2.21pct 至 16.43%。同时，公司持续加码 AI 终端、智能汽车及 AI 算力硬件布局，AI 眼镜、具身智能相关产品加快客户导入，TGV 玻璃基板、HDD 玻璃盘片和服务器结构件及存储等新业务持续推进。整体来看，公司传统消费电子业务仍处调整期，但 Q2 归母净利润恢复正增长，新业务布局逐步进入验证和放量阶段，后续关注 AI 硬件新品进展及消费电子需求修复。

图表70：蓝思科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表71：蓝思科技归母净利润情况

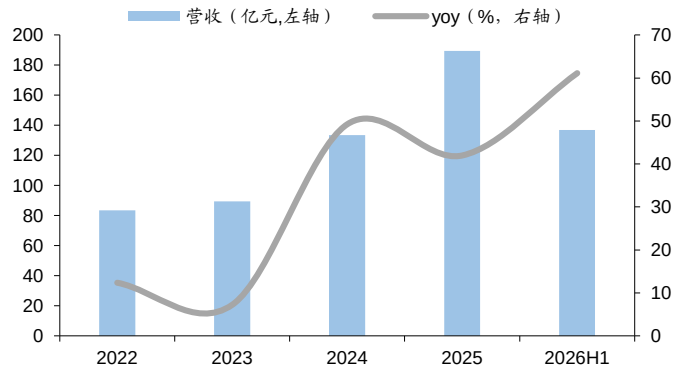


来源：ifind，国金证券研究所

3.2：PCB

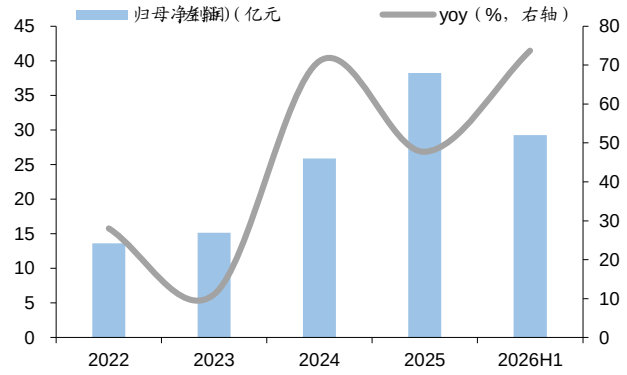
沪电股份：2026H1 公司实现营业收入 136.89 亿元，同比+61.17%；归母净利润 29.23 亿元，同比+73.72%；扣非归母净利润 27.95 亿元，同比+70.00%。其中，2026Q2 实现营业收入 74.75 亿元，同比+67.75%；归母净利润 16.81 亿元，同比+82.69%。公司深耕高端 PCB，受益 AI 服务器、高速交换机及 HPC 需求持续旺盛，数据通讯应用收入同比+73.46%，32 层及以上高阶 PCB 产品加速放量；产品结构优化带动 PCB 业务毛利率提升至 40.52%。同时泰国基地二季度实现扭亏，海外产能与交付能力逐步释放。整体来看，公司 Q2 营收及盈利增速进一步提升，高阶产品放量与海外产能释放形成共振，AI 算力高景气有望继续支撑公司业绩保持较快增长。

图表72：沪电股份营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

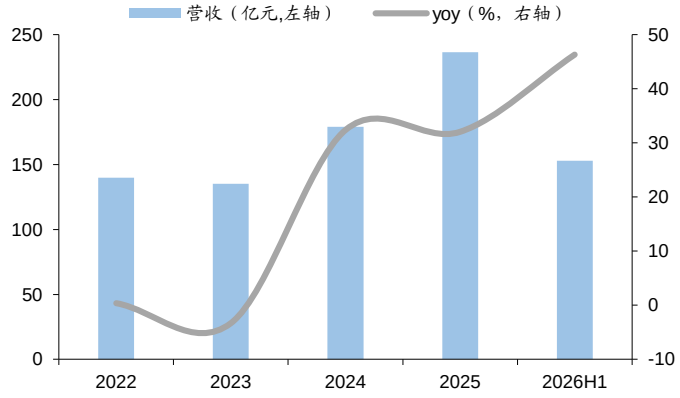
图表73：沪电股份归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

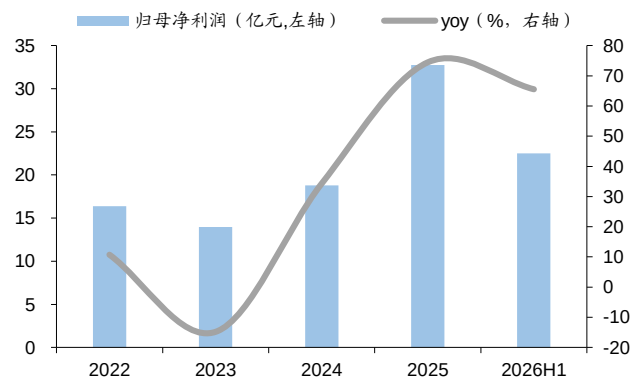
深南电路：2026H1 公司实现营业收入 152.96 亿元，同比+46.33%；归母净利润 22.51 亿元，同比+65.55%；扣非归母净利润 22.39 亿元，同比+76.94%。其中，2026Q2 实现营业收入 87.01 亿元，同比+53.44%；归母净利润 14.01 亿元，同比+61.33%。公司 PCB 与封装基板双主业协同增长，受益 AI 服务器、高速交换机及汽车电子需求提升，高阶 PCB 产品持续放量；封装基板业务加速修复，收入同比+110.76%，毛利率提升至 31.35%，广州工厂产能爬坡顺利。同时公司持续推进南通四期、泰国工厂等产能建设，强化高端 PCB 及封装基板全球交付能力。整体来看，公司 Q2 营收和盈利延续较快增长，高阶 PCB 与封装基板共同贡献增量，随着新产能逐步释放及高端产品占比提升，业绩增长动能有望延续。

图表74：深南电路营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

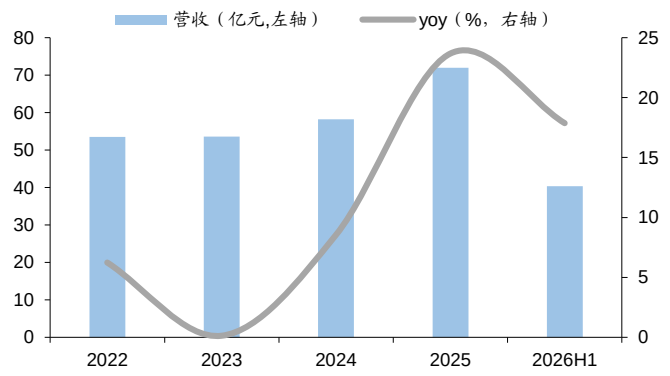
图表75：深南电路归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

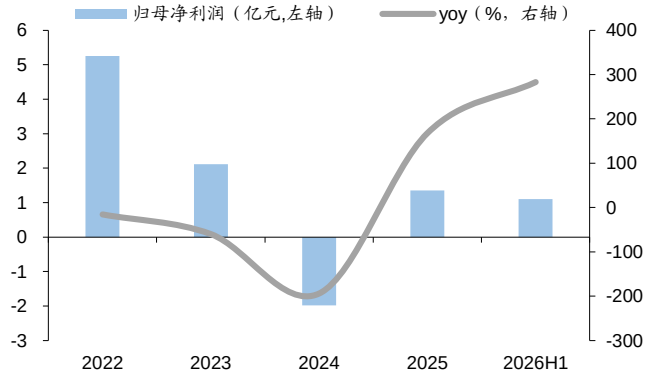
兴森科技：2026H1 公司实现营业收入 40.38 亿元，同比+17.86%；归母净利润 1.11 亿元，同比+283.27%；扣非归母净利润 1.25 亿元，同比+166.90%。其中，2026Q2 实现营业收入 22.20 亿元，同比+20.22%；归母净利润 0.92 亿元，同比+371.53%。公司 PCB 业务保持稳健，子公司宜兴硅谷由前期减亏进一步实现扭亏，盈利改善趋势更加明确；IC 封装基板业务受益需求回暖及产品结构优化，CSP 封装基板量价齐升、订单保持饱满，带动封装基板盈利能力修复。同时，1.6T 光模块 PCB 进入量产爬坡阶段，FCBGA 仍处小批量及客户导入期。整体来看，公司 Q2 盈利弹性进一步释放，CSP 封装基板改善与高端 PCB 新品放量共同推动经营拐点逐步确认。

图表76：兴森科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

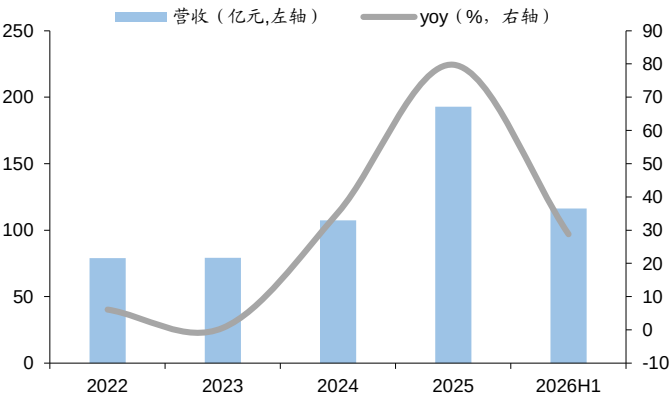
图表77：兴森科技归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

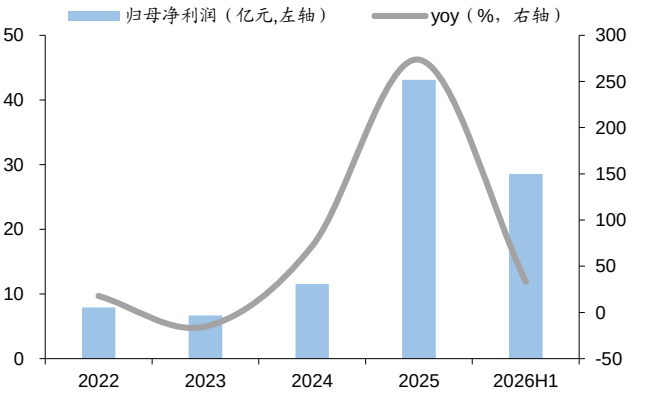
胜宏科技：2026H1 公司实现营业收入 116.29 亿元，同比+28.77%；归母净利润 28.57 亿元，同比+33.30%；扣非归母净利润 24.18 亿元，同比+12.50%。其中，2026Q2 实现营业收入 61.10 亿元，同比+29.48%；归母净利润 15.68 亿元，同比+28.29%。公司聚焦高多层、高阶 HDI 等高端 PCB，持续受益 AI 服务器、交换机及加速卡等算力硬件需求增长，高端产品结构与客户份额进一步提升；同时推进海外产能建设，增强全球客户配套与交付能力。上半年经营现金流净额同比+144.61%至 29.11 亿元，经营质量同步改善。整体来看，受 2025 年高基数影响，公司 H1 增速较此前明显回落，但 Q2 收入仍维持近 30%增长，AI 算力需求及高端 PCB 产品升级有望继续支撑公司业绩稳健增长。

图表78：胜宏科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

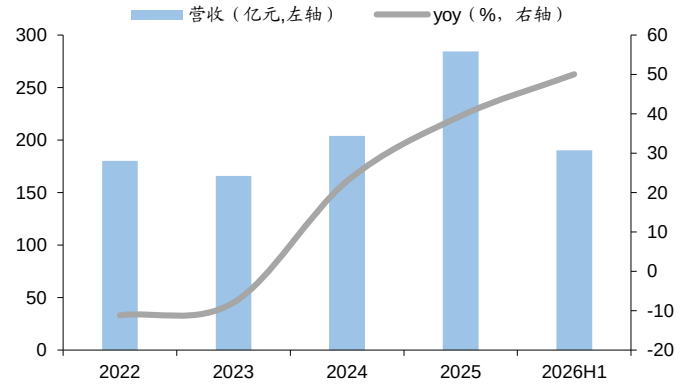
图表79：胜宏科技归母净利润情况



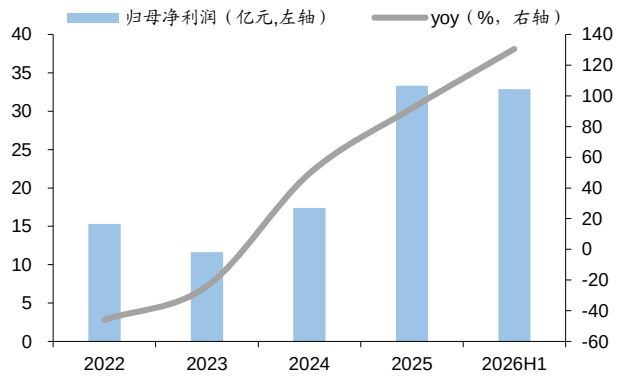
来源：ifind，国金证券研究所

生益科技：2026H1 公司实现营业收入 190.26 亿元，同比+50.05%；归母净利润 32.87 亿元，同比+130.42%；扣非归母净利润 29.08 亿元，同比+110.99%。其中，2026Q2 实现营业收入 108.84 亿元，同比+53.98%；归母净利润 21.29 亿元，同比+146.72%。公司持续受益 AI 服务器、高速交换机及光模块等需求增长，高速高频覆铜板、粘结片等高端产品量价齐升，产品结构优化带动盈利能力明显改善；子公司生益电子高附加值 PCB 产品同步放量，进一步强化算力产业链布局。整体来看，公司 Q2 营收及盈利增速进一步提升，高端材料升级叠加下游高景气持续释放利润弹性，业绩增长动能较强。

图表80：生益科技营收情况



图表81：生益科技归母净利润情况

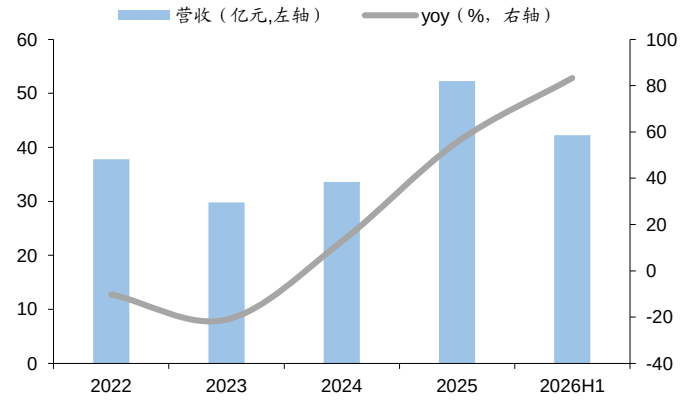


来源：ifind，国金证券研究所

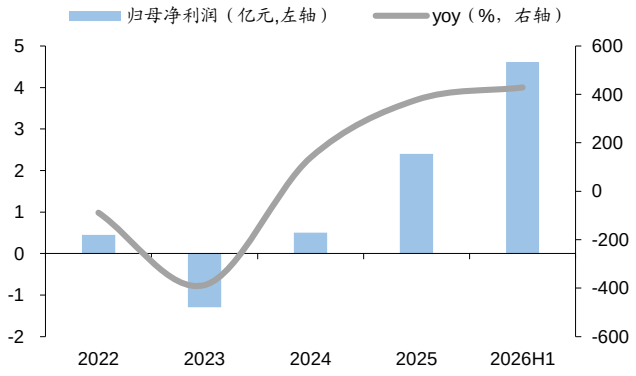
来源：ifind，国金证券研究所

南亚新材：2026H1 公司实现营业收入 42.24 亿元，同比+83.23%；归母净利润 4.61 亿元，同比+428.80%；扣非归母净利润 4.53 亿元，同比+457.77%。其中，2026Q2 实现营业收入 23.91 亿元，同比+76.80%；归母净利润 3.11 亿元，同比+370.62%。公司持续受益 AI 服务器、高速交换机等需求增长，高速高频覆铜板景气度提升，带动产品销量、售价及高端产品占比同步上行；同时原材料涨价向下游传导较为顺畅，综合毛利率提升至 21.68%。公司持续推进高阶产品认证及新增产能建设，进一步增强 AI 算力材料配套能力。整体来看，公司 Q2 延续高增长，高端产品放量叠加行业景气上行持续释放利润弹性，盈利能力处于快速改善阶段。

图表82：南亚新材营收情况



图表83：南亚新材归母净利润情况

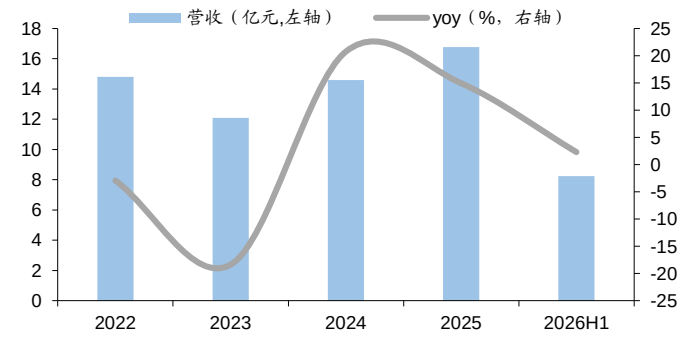


来源：ifind，国金证券研究所

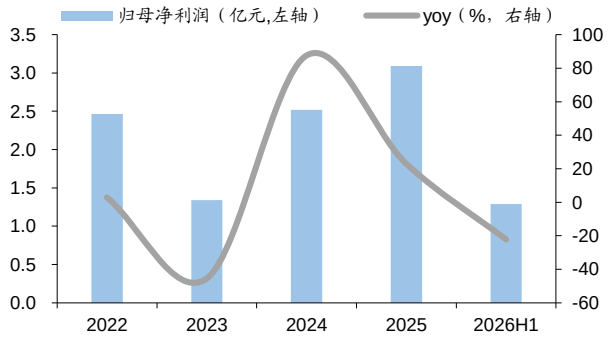
来源：ifind，国金证券研究所

瑞联新材：2026H1 公司实现营业收入 8.25 亿元，同比+2.27%；归母净利润 1.29 亿元，同比-22.30%；扣非归母净利润 1.21 亿元，同比-25.66%。其中，2026Q2 实现营业收入 4.46 亿元，同比-3.56%；归母净利润 0.85 亿元，同比-29.10%。公司材料业务整体保持稳健，医药板块受客户备货节奏影响有所承压；电子材料业务加速放量，上半年收入同比+161.82%，ArF 光刻胶单体、PSPI 及封装胶材料等产品持续推进客户导入，逐步成为新的增长来源。受汇率、原材料及产品结构影响，公司综合毛利率降至 41.23%。整体来看，传统业务短期仍有压力，但半导体材料高增长逐步兑现，随着新品客户验证及规模放量，业务结构有望持续改善。

图表84：瑞联新材营收情况



图表85：瑞联新材归母净利润情况



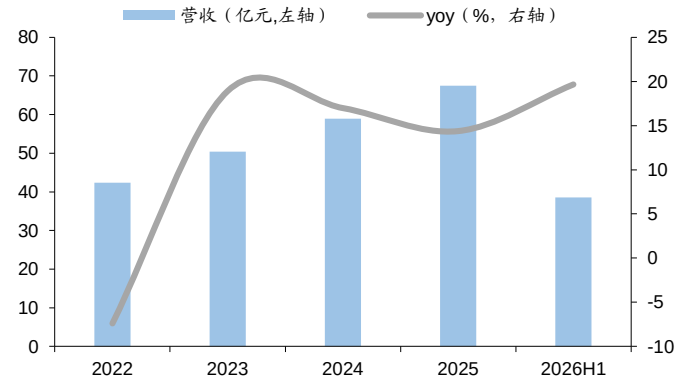
来源：ifind，国金证券研究所

来源：ifind，国金证券研究所

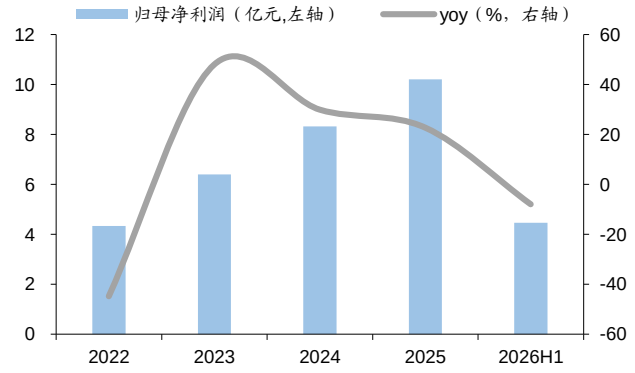
3.3：被动元件

顺络电子：2026H1 公司实现营业收入 38.59 亿元，同比+19.67%；归母净利润 4.47 亿元，同比-7.98%；扣非归母净利润 4.34 亿元，同比-6.21%。其中，2026Q2 实现营业收入 21.74 亿元，同比+23.26%；归母净利润 2.69 亿元，同比+6.53%。公司以电感等磁性元件为核心，上半年消费电子业务保持稳健，汽车电子收入同比增长超过 30%，储能需求回暖；同时 AI 服务器供电升级带动高功率电感、TLVR 等产品需求快速增长，新型钽电容及光通信陶瓷配套产品持续推进。受贵金属等原材料涨价影响，上半年利润有所承压，但 Q2 毛利率环比提升 1.88pct 至 34.41%，盈利能力边际修复。整体来看，公司收入增速进一步提升，汽车与 AI 业务逐步成为新增量，若成本传导持续落地，利润增速有望进一步修复。

图表86：顺络电子营收情况



图表87：顺络电子归母净利润情况

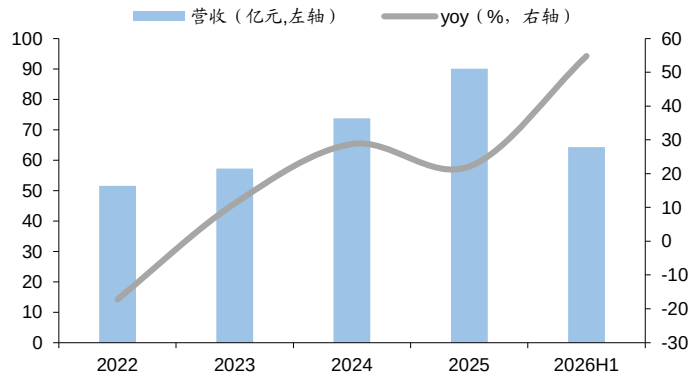


来源：ifind，国金证券研究所

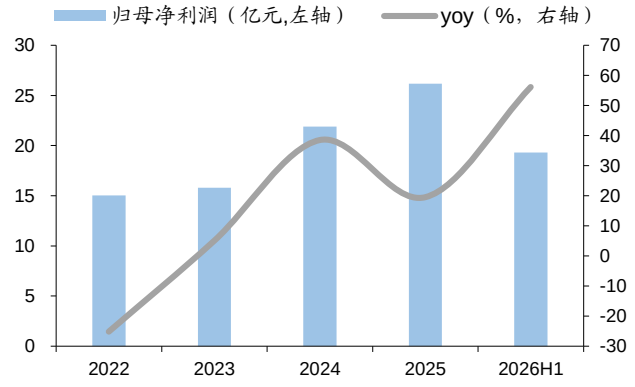
来源：ifind，国金证券研究所

三环集团：2026H1 公司实现营业收入 64.23 亿元，同比+54.82%；归母净利润 19.32 亿元，同比+56.18%；扣非归母净利润 18.09 亿元，同比+69.66%。其中，2026Q2 实现营业收入 37.42 亿元，同比+61.61%；归母净利润 11.41 亿元，同比+61.99%。公司以 MLCC 及电子陶瓷元件为核心，上半年受益 AI 服务器、数据中心及汽车电子等高端需求增长，高容 MLCC 销量与价格同步改善，产品结构持续升级；同时全球数据中心建设带动陶瓷插芯、套筒等光通信产品需求提升。上半年电子、通信元件及材料业务收入同比+54.97%，毛利率提升 2.52pct 至 44.23%，高附加值产品放量推动盈利能力进一步增强。整体来看，公司 Q2 延续较快增长，MLCC 量价改善叠加光通信需求放量形成双重驱动，高端化与产品结构升级有望继续支撑业绩增长。

图表88：三环集团营收情况



图表89：三环集团归母净利润情况

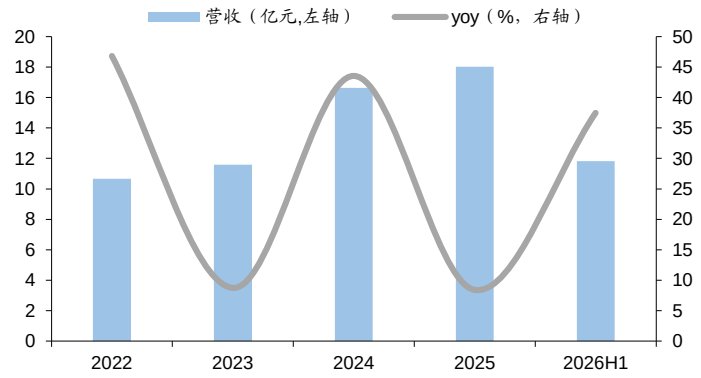


来源：ifind，国金证券研究所

来源：ifind，国金证券研究所

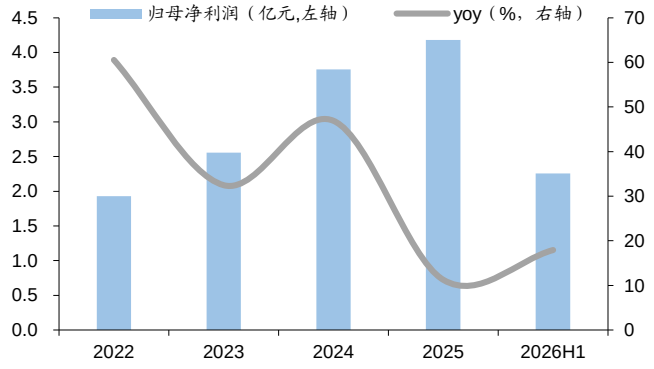
铂科新材：2026H1 公司实现营业收入 11.83 亿元，同比+37.46%；归母净利润 2.26 亿元，同比+17.95%；扣非归母净利润 2.23 亿元，同比+18.71%。其中，2026Q2 实现营业收入 6.94 亿元，同比+45.30%；归母净利润 1.37 亿元，同比+16.66%。公司以金属软磁粉芯和芯片电感为核心业务，上半年储能、服务器电源及 UPS 需求保持较快增长，金属软磁粉芯基本盘稳健；同时 AI 芯片电感持续放量，TLVR 电感占 AI 芯片电感收入比例已超过 30%，客户认可度和产品渗透率进一步提升。2026H1 电子元器件毛利率为 38.65%，受股权激励股份支付及部分成本因素影响利润增速低于收入。整体来看，公司 Q2 收入增速进一步提升，AI 芯片电感逐步成为重要增量，随着新增产能释放及高附加值产品占比提升，盈利弹性有望进一步增强。

图表90：铂科新材营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

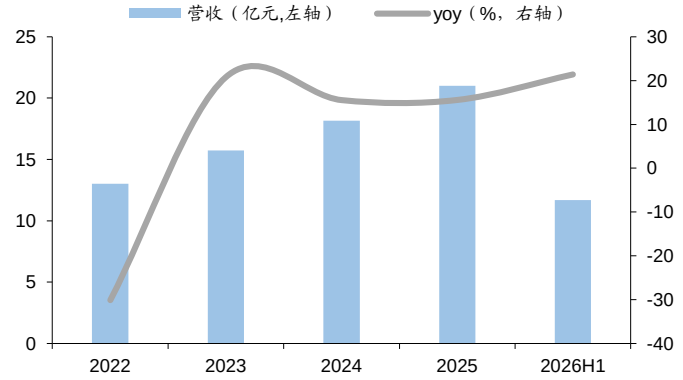
图表91：铂科新材归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

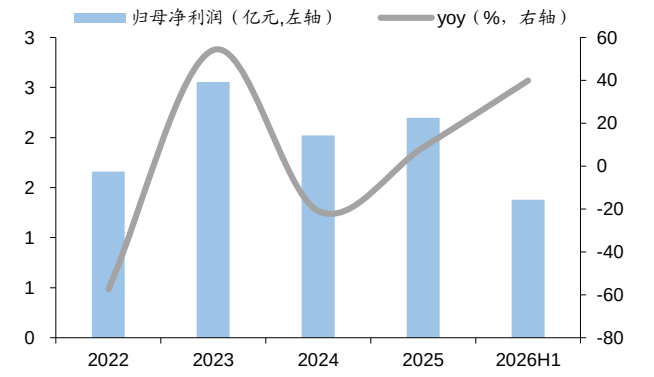
洁美科技：2026H1 公司实现营业收入 11.69 亿元，同比+21.42%；归母净利润 1.38 亿元，同比+39.87%；扣非归母净利润 1.01 亿元，同比+6.46%。其中，2026Q2 实现营业收入 6.61 亿元，同比+20.59%；归母净利润 0.90 亿元，同比+38.98%。公司以电子封装载带为基本盘，上半年受益小型化、车载及半导体载带需求增长，电子封装材料业务保持稳健；电子级薄膜材料加速放量，收入同比+78.99%，离型膜月出货量由 1 月约 2100 万平方米提升至 6 月超过 4000 万平方米，BOPET 基膜二期投产后自供能力进一步增强，离型膜与基膜一体化优势持续兑现。归母利润高增包含旧厂房处置收益，扣非利润更能反映主业盈利情况。整体来看，公司薄膜材料业务已成为重要增量，随着高端离型膜国产替代及海外客户放量，业务结构和盈利能力有望进一步改善。

图表92：洁美科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表93：洁美科技归母净利润情况

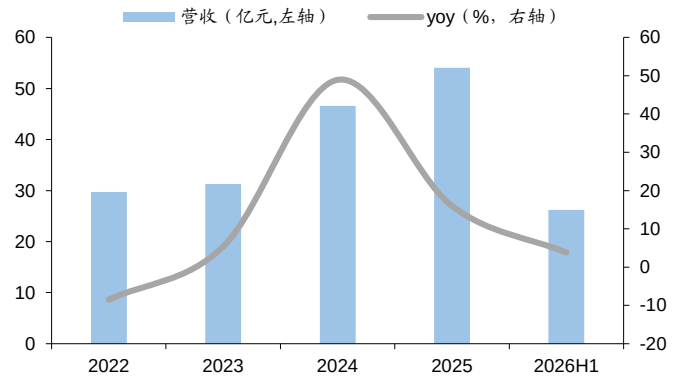


来源：ifind，国金证券研究所

3.4：汽车电子

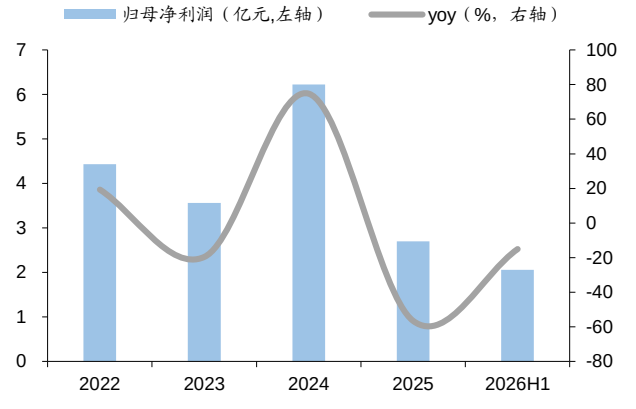
电连技术：2026H1 公司实现营业收入 26.21 亿元，同比+3.82%；归母净利润 2.06 亿元，同比-15.13%；扣非归母净利润 2.04 亿元，同比-14.67%。其中，2026Q2 实现营业收入 14.29 亿元，同比+7.62%；归母净利润 1.19 亿元，同比-0.47%。公司以消费电子微型连接器为基本盘，持续拓展汽车 FAKRA、HSD 及以太网等高速连接产品，受益汽车智能化及高速数据传输需求提升，汽车业务仍是主要成长方向。Q2 毛利率环比提升 1.39pct 至 29.70%，盈利能力较 Q1 边际改善，但汇率、原材料及费用投入仍对上半年利润形成一定压力。整体来看，公司收入增速逐步回升，汽车高速连接业务持续贡献增量，伴随产品结构优化及盈利能力修复，经营表现有望进一步改善。

图表94：电连技术营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

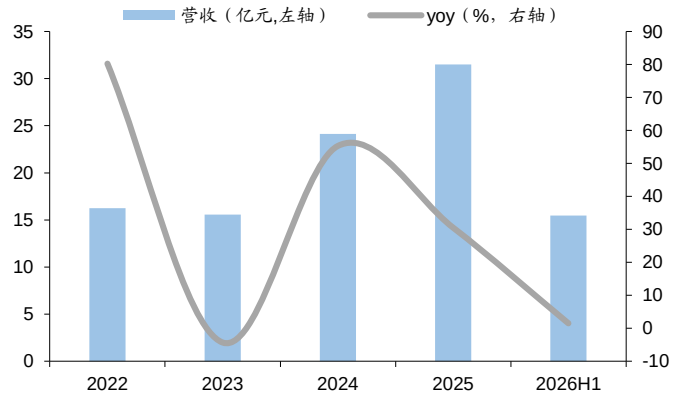
图表95：电连技术归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

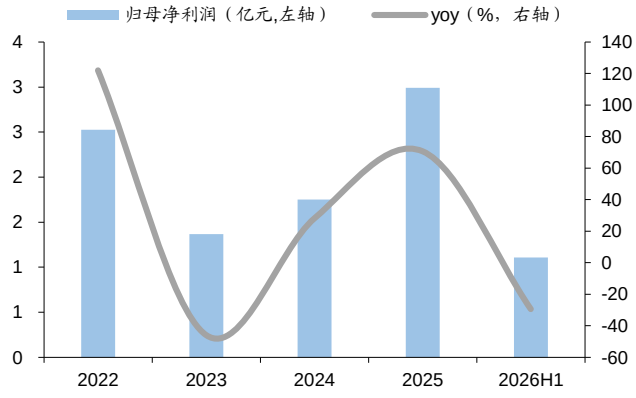
瑞可达：2026H1 公司实现营业收入 15.48 亿元，同比+1.51%；归母净利润 1.11 亿元，同比-29.36%；扣非归母净利润 1.06 亿元，同比-28.21%。其中，2026Q2 实现营业收入 7.96 亿元，同比+4.29%；归母净利润 0.52 亿元，同比-36.12%。公司以新能源汽车及储能连接器为基本盘，持续拓展数据中心高速铜缆等新业务，高速铜缆连接组件已开始放量并逐步拓展客户，有望成为新的成长方向。受项目价格调整、市场竞争及财务费用上升影响，上半年综合毛利率降至 21.98%，利润仍有压力，但经营现金流明显改善。整体来看，公司收入端逐步企稳，新业务开始贡献增量，随着高速铜缆放量及产品结构改善，盈利能力有望逐步修复。

图表96：瑞可达营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表97：瑞可达归母净利润情况

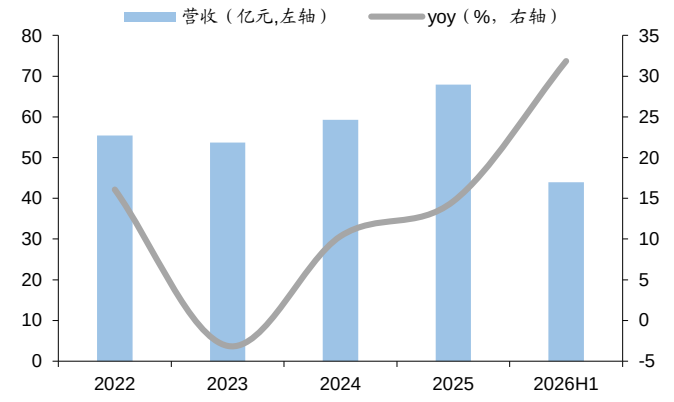


来源：ifind，国金证券研究所

3.5：半导体设计

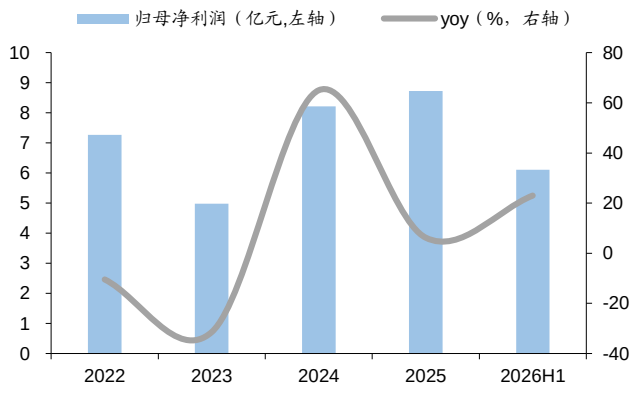
晶晨股份：2026H1 公司实现营业收入 43.91 亿元，同比+31.86%；归母净利润 6.11 亿元，同比+23.00%；扣非归母净利润 5.60 亿元，同比+22.56%。其中，2026Q2 实现营业收入 24.96 亿元，同比+38.61%；归母净利润 4.38 亿元，同比+41.89%。公司智能视觉与媒体 SoC 基本盘稳健，高端产品持续放量，Wi-Fi/蓝牙等连接芯片同步增长；同时围绕边缘 AI 持续推进新品研发与客户导入，进一步完善“主控 SoC+连接芯片”的产品矩阵。上半年综合毛利率同比提升 1.93pct 至 38.73%，产品结构优化带动盈利能力改善。整体来看，公司 Q2 收入和利润增速进一步提升，高端化与多品类拓展逻辑持续兑现，成长动能有所增强。

图表98：晶晨股份营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

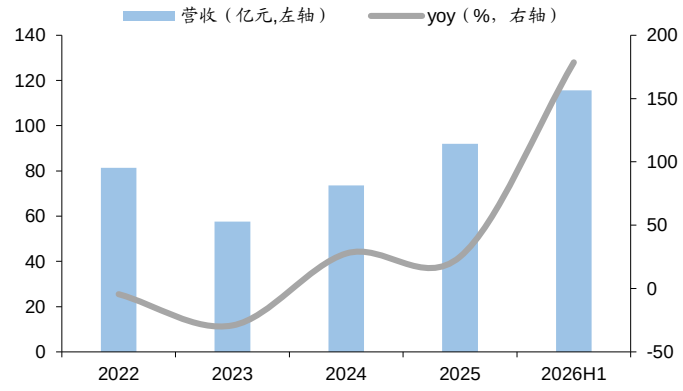
图表99：晶晨股份归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

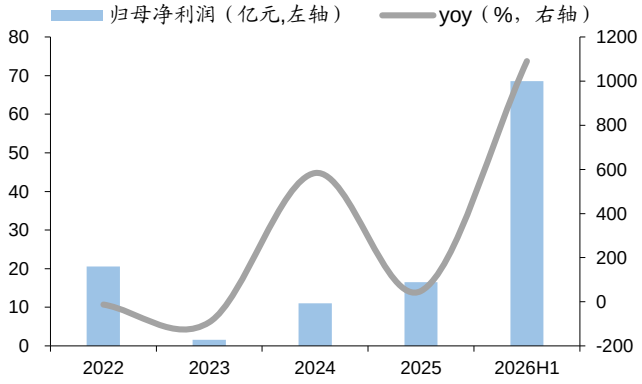
兆易创新：2026H1 公司实现营业收入 115.66 亿元，同比+178.67%；归母净利润 68.57 亿元，同比+1091.50%；扣非归母净利润 48.83 亿元，同比+796.90%。其中，2026Q2 实现营业收入 73.78 亿元，同比+229.18%；归母净利润 53.96 亿元，同比+1482.99%。公司持续完善存储、MCU 及传感器等产品矩阵，上半年受益存储供需偏紧及价格上行，NOR Flash、NAND 及利基 DRAM 业务快速增长，MCU 出货亦保持较好增速；同时公允价值变动等非经常性收益进一步放大利润弹性，但扣非业绩同样实现大幅增长。整体来看，公司正处于存储景气上行与产品平台扩张共振阶段，Q2 业绩弹性进一步释放，后续盈利表现仍将主要取决于存储价格、库存周期及产品结构变化。

图表100：兆易创新营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

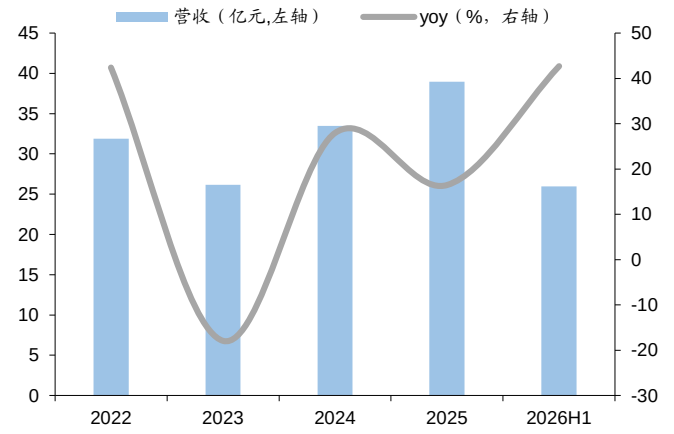
图表101：兆易创新归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

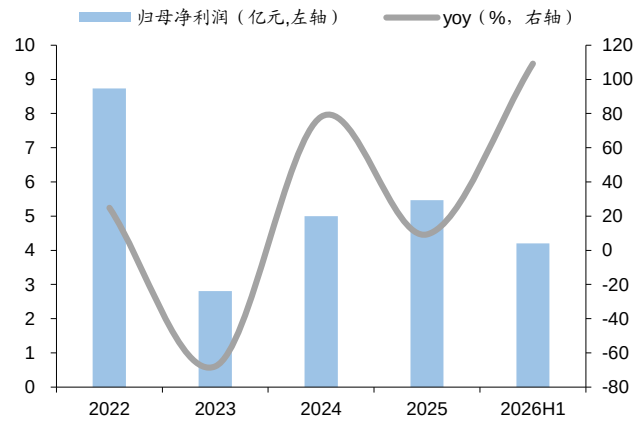
圣邦股份：2026H1 公司实现营业收入 25.95 亿元，同比+42.70%；归母净利润 4.20 亿元，同比+109.28%；扣非归母净利润 3.56 亿元，同比+164.56%。其中，2026Q2 实现营业收入 14.97 亿元，同比+45.48%；归母净利润 2.97 亿元，同比+110.26%。公司持续完善信号链与电源管理两大模拟芯片平台，上半年两类产品收入分别同比+53.13%/+35.45%，受益工业、汽车及 AI 算力等下游需求增长，高速接口、光模块及高端电源管理产品加•快客户导入。产品结构优化带动综合毛利率同比提升 1.68pct 至 51.84%。整体来看，公司 Q2 收入及利润增速进一步提升，平台化扩品类与高端产品放量逐步兑现，盈利弹性明显增强。

图表102：圣邦股份营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

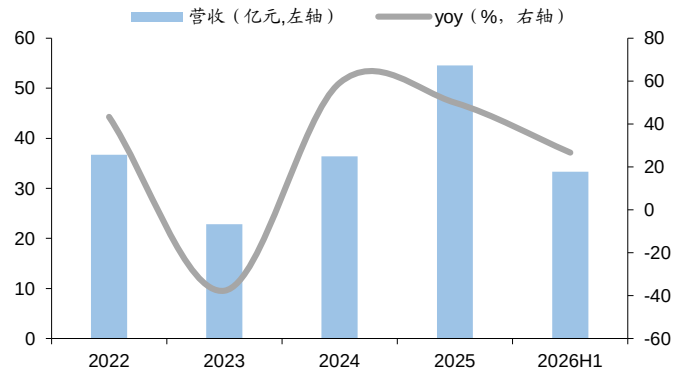
图表103：圣邦股份归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

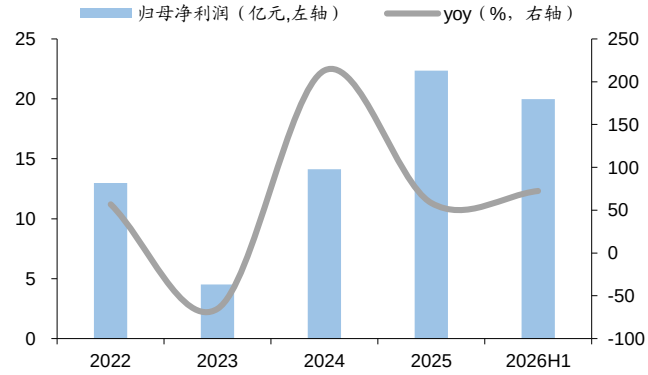
澜起科技：2026H1 公司实现营业收入 33.35 亿元，同比+26.66%；归母净利润 19.97 亿元，同比+72.33%；扣非归母净利润 13.22 亿元，同比+21.17%。其中，2026Q2 实现营业收入 18.75 亿元，同比+32.84%；归母净利润 11.50 亿元，同比+81.50%。公司持续受益 AI 算力需求增长及 DDR5 平台升级，内存接口芯片基本盘稳健，MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD 及 CXL MXC 等互连新品加速放量，上半年四款新品收入同比+80.7%，互连类芯片毛利率提升至 69.3%。整体来看，公司互连类芯片高景气延续，新产品矩阵持续完善并逐步贡献增量，AI 服务器及数据中心互连需求有望继续支撑公司成长。

图表104：澜起科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表105：澜起科技归母净利润情况

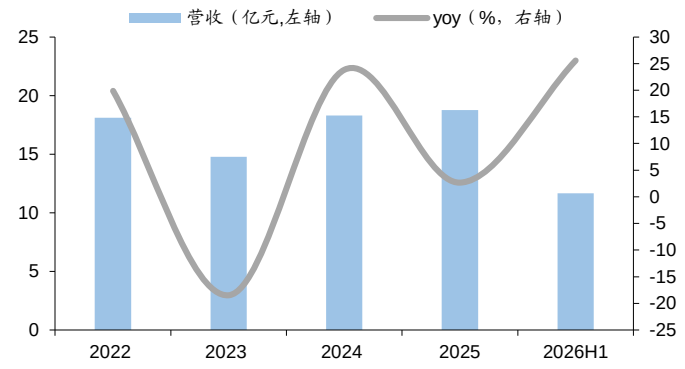


来源：ifind，国金证券研究所

3.6：功率半导体

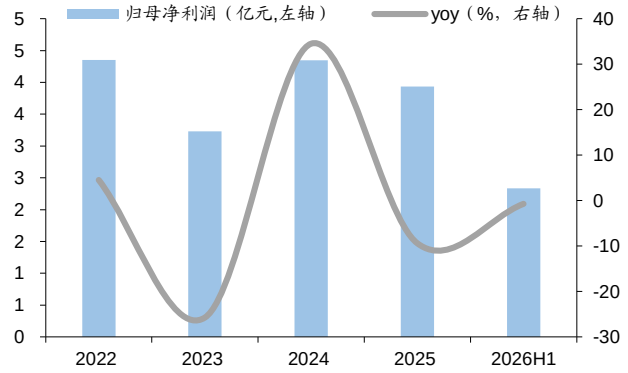
新洁能：2026H1 公司实现营业收入 11.67 亿元，同比+25.57%；归母净利润 2.33 亿元，同比-0.75%；扣非归母净利润 1.94 亿元，同比-6.49%。其中，2026Q2 实现营业收入 6.50 亿元，同比+35.30%；归母净利润 1.39 亿元，同比+9.44%。公司聚焦中高端功率半导体，持续完善 MOSFET、IGBT 及 SiC 等产品矩阵，受益 AI 服务器电源、新能源汽车、储能及机器人等下游需求增长，上半年产品销量保持较快提升；同时 12 英寸工艺平台及 SiC 产品持续推进，进一步向高压、高功率应用延伸。受行业价格竞争及产品结构变化影响，H1 利润增速低于收入，但 Q2 归母净利润恢复正增长。整体来看，公司需求端已由传统消费及工业逐步向 AI、新能源等高景气场景拓展，产品升级叠加销量增长有望推动盈利能力逐步修复。

图表106：新洁能营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表107：新洁能归母净利润情况

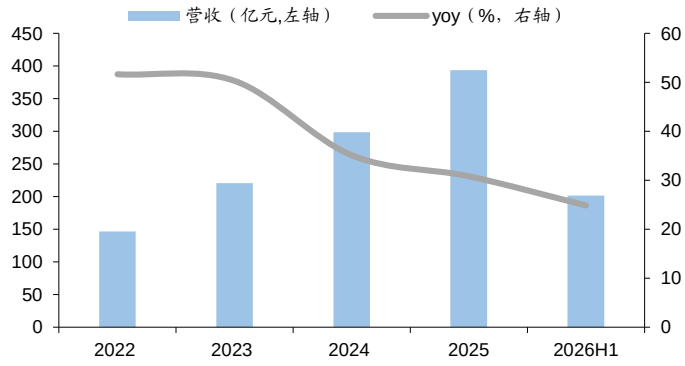


来源：ifind，国金证券研究所

3.7：半导体设备

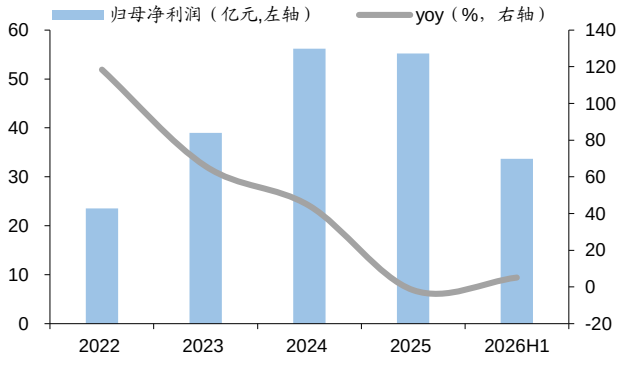
北方华创：2026H1 公司实现营业收入 201.61 亿元，同比+24.90%；归母净利润 33.70 亿元，同比+5.05%；扣非归母净利润 33.41 亿元，同比+5.02%。其中，2026Q2 实现营业收入 98.39 亿元，同比+23.98%；归母净利润 17.35 亿元，同比+6.64%。公司作为国内平台型半导体设备龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等核心环节，持续受益国内晶圆厂扩产及关键设备国产化加速；随着先进制程、存储及先进封装产线持续建设，公司新品验证与批量交付稳步推进，平台化优势进一步强化。上半年研发投入保持高位，叠加新品导入及产品结构变化，综合毛利率同比下降 2.10pct 至 40.07%，利润增速低于收入。整体来看，公司收入端维持较快增长，当前仍处高研发投入与产品扩张阶段，随着新品放量及规模效应逐步体现，盈利能力有望进一步改善。

图表108：北方华创营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

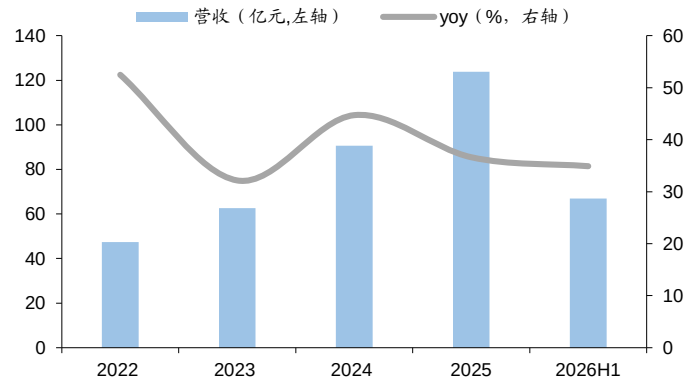
图表109：北方华创归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

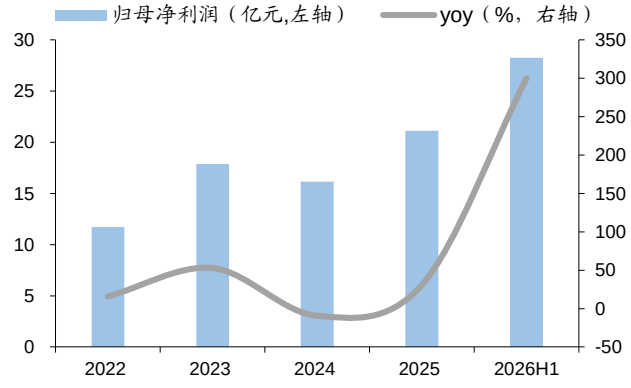
中微公司：2026H1 公司实现营业收入 66.91 亿元，同比+34.89%；归母净利润 28.25 亿元，同比+300.22%；扣非归母净利润 11.23 亿元，同比+108.36%。其中，2026Q2 实现营业收入 37.76 亿元，同比+35.48%；归母净利润 18.95 亿元，同比+382.32%。公司聚焦刻蚀、薄膜沉积等核心半导体设备，持续受益先进制程、存储扩产及设备国产化加速，刻蚀设备保持核心优势，薄膜沉积业务持续突破，多款钨沉积设备已实现关键客户验证并取得重复订单，产品平台化布局进一步完善。上半年主业保持较快增长，扣非利润实现翻倍，规模效应与新品放量逐步体现；投资及公允价值收益进一步增厚归母利润。整体来看，公司正由刻蚀设备龙头向多品类设备平台延伸，成长动能持续增强。

图表110：中微公司营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

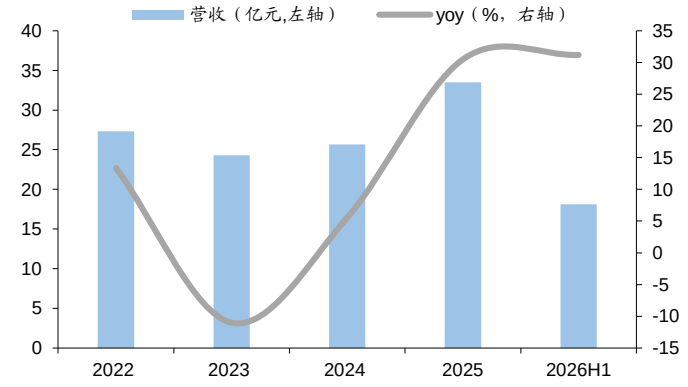
图表111：中微公司归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

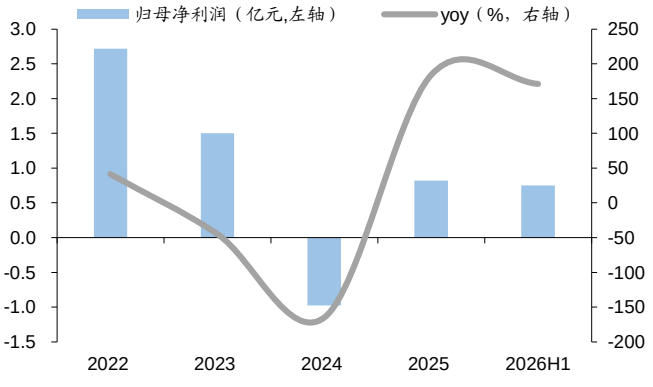
精测电子：2026H1 公司实现营业收入 18.12 亿元，同比+31.19%；归母净利润 0.75 亿元，同比+171.21%；扣非归母净利润 0.30 亿元，实现扭亏。其中，2026Q2 实现营业收入 10.73 亿元，同比+55.04%；归母净利润 0.32 亿元、扣非归母净利润 0.18 亿元，均实现同比扭亏。公司以显示检测业务为基本盘，半导体量检测及测试设备加速放量，受益国内晶圆厂扩产及设备国产化推进，相关订单与收入保持较快增长，成为当前主要增量来源；同时公司持续加大先进制程检测设备研发和客户验证投入，上半年综合毛利率维持在 40%+。整体来看，公司 Q2 盈利拐点进一步显现，半导体业务增长正逐步改善整体盈利表现，随着订单持续转化和规模效应释放，经营质量有望继续提升。

图表112：精测电子营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

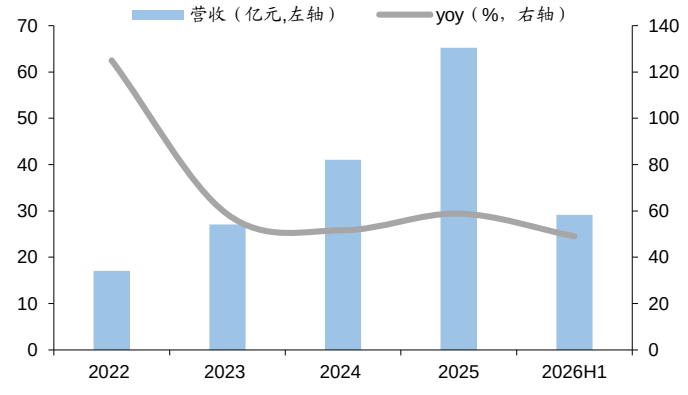
图表113：精测电子归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

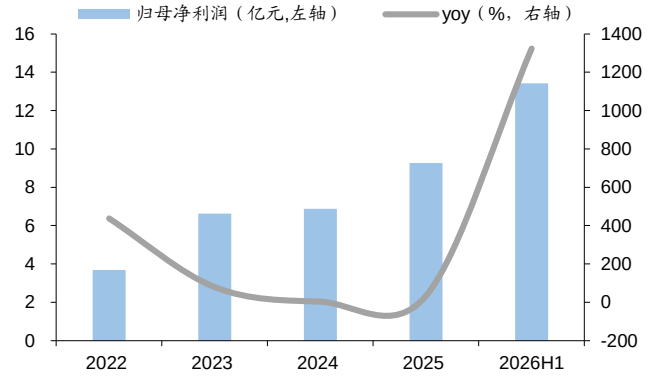
拓荆科技：2026H1 公司实现营业收入 29.13 亿元，同比+49.06%；归母净利润 13.43 亿元，同比+1324.10%；扣非归母净利润 3.67 亿元，同比+861.92%。其中，2026Q2 实现营业收入 18.00 亿元，同比+44.56%；归母净利润 7.72 亿元，同比+220.08%。公司聚焦薄膜沉积设备，持续受益国内晶圆厂扩产及设备国产化推进，PECVD、ALD、SACVD 等产品矩阵不断完善，并逐步向先进逻辑、存储及先进封装等应用延伸。随着客户验证和批量交付推进，公司薄膜沉积设备逐步放量，规模效应带动扣非利润明显改善，同时，上半年交易性金融资产公允价值变动收益增加约 9.60 亿元，对归母净利润形成较大增厚。整体来看，公司由前期新品验证逐步进入多品类放量阶段，薄膜沉积设备平台化布局持续兑现，主业成长动能进一步增强。

图表114：拓荆科技营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

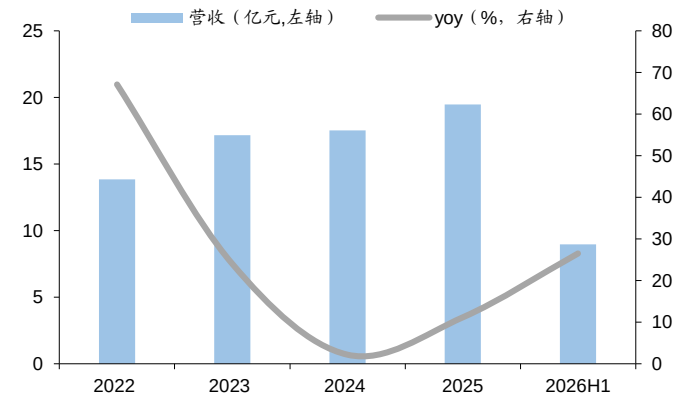
图表115：拓荆科技归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

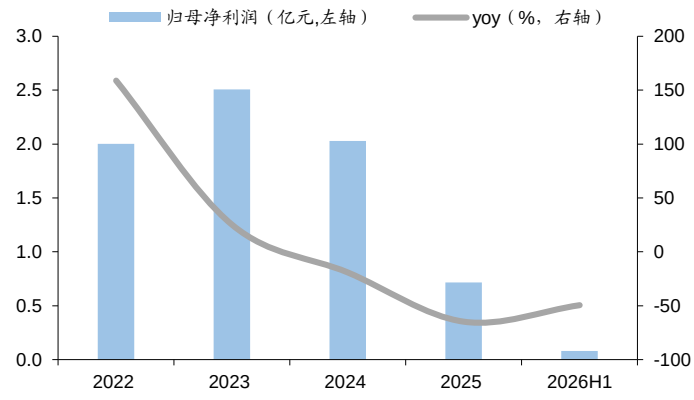
芯源微：2026H1 公司实现营业收入 8.97 亿元，同比+26.47%；归母净利润 0.08 亿元，同比-49.37%；扣非归母净利润-0.45 亿元，亏损同比有所收窄。其中，2026Q2 实现营业收入 5.66 亿元，同比+30.53%；归母净利润 0.05 亿元，同比-59.58%。公司聚焦涂胶显影、清洗及先进封装等半导体设备，持续受益国内晶圆厂扩产及设备国产化推进，前道涂胶显影业务保持优势，化学清洗及先进封装相关产品持续拓展客户与应用场景。上半年收入维持较快增长，但研发、市场拓展及交付投入仍对利润形成压力。整体来看，公司当前仍处新品导入和规模爬坡阶段，收入端增长已较为明确，后续盈利改善有望伴随新品验收及规模效应逐步体现。

图表116：芯源微营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表117：芯源微归母净利润情况

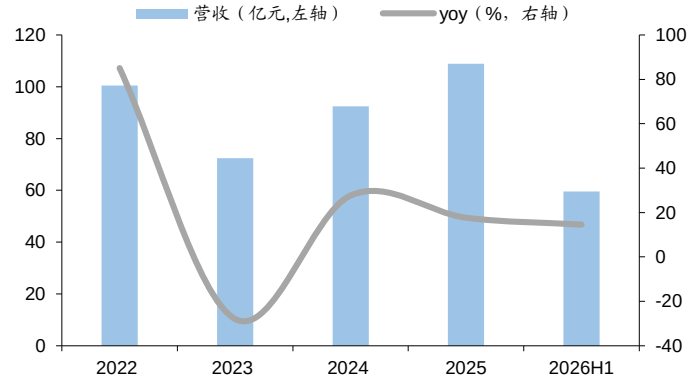


来源：ifind，国金证券研究所

3.8：晶圆代工

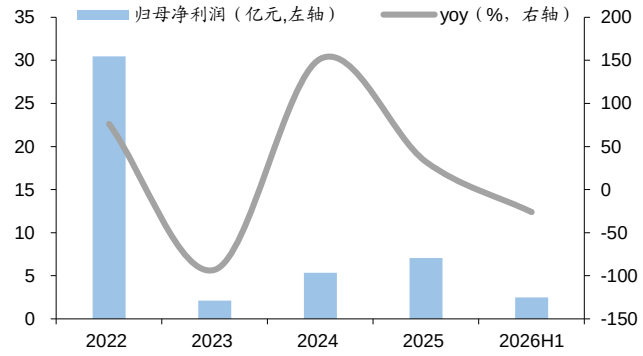
晶合集成：2026H1 公司实现营业收入 59.57 亿元，同比+14.59%；归母净利润 2.45 亿元，同比-26.12%；扣非归母净利润 1.31 亿元，同比-35.90%。其中，2026Q2 实现营业收入 30.45 亿元，同比+15.73%；归母净利润 1.95 亿元，同比-0.99%。公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，以显示驱动芯片代工为基本盘，持续向 CIS（CMOS 图像传感器）、PMIC（电源管理芯片）等高附加值特色工艺延伸，上半年 CIS 和 PMIC 收入占比分别提升至 25.34%和 12.82%，业务结构进一步优化，28nm 等新平台持续推进验证，22nm 逻辑芯片工艺开发中。受产品价格调整、折旧及股权激励影响，上半年盈利仍有压力，但 Q2 归母净利润降幅已明显收窄。整体来看，公司非显示驱动业务占比持续提升，产品结构升级逐步兑现，随着高阶工艺平台放量及产能利用率改善，盈利能力有望逐步修复。

图表118：晶合集成营收情况



来源：ifind，国金证券研究所

图表119：晶合集成归母净利润情况



来源：ifind，国金证券研究所

四、投资建议

一、AI 硬件算力产业链

AI 算力需求持续强劲，上半年产业链业绩高景气得到进一步验证。谷歌 TPU 等自研 ASIC 持续迭代，北美云厂商资本开支维持高位，先进制程及高端算力硬件需求旺盛。随着新一代 GPU 及谷歌、亚马逊等 ASIC 产品持续拉货，AI 服务器、高速交换机等需求有望继续保持较快增长，持续看好 AI 产业链硬件核心公司。目前多家 AI-PCB 公司订单强劲，高阶产能维持较高稼动率并持续扩产，高多层板、高阶 HDI 等高端产品需求旺盛；同时 AI 覆铜板需求持续提升，高端产能供给相对紧张，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。AI 覆铜板/PCB 的强劲需求也将进一步带动配套设备（钻孔机、直写光刻设备、钻针等）及上游电子布、铜箔等环节需求。

二、半导体芯片/存储/设备/零部件/材料产业链

半导体产业链逆全球化趋势延续，外部制裁及供应链安全需求推动国内设备、材料、零部件加快下游验证导入，自主可控及国产替代持续推进。2026 年上半年国内晶圆厂资本开支维持较高强度，先进逻辑及存储产线持续扩产，晶圆厂稼动率维持较高水平，设备板块收入保持较快增长；同时存储价格上行、国产 AI 算力芯片放量推动半导体设计板块盈利能力显著改善。随着国内先进制程、先进存储产能持续建设以及核心设备、零部件和材料国产化率进一步提升，我们认为半导体产业链自主可控逻辑仍具有较强持续性，建议持续关注核心龙头公司。建议关注：北方华创、寒武纪、安集科技、中芯国际、汇成真空、鼎龙股份、江丰电子、思特威、芯源微、中微公司、长鑫存储、纳芯微。美股：博通、英伟达、台积电、天弘科技、Credo。

三、苹果创新、AI 智能眼镜、机器人受益产业链

存储价格上涨对苹果产业链影响无需过分悲观，2026-2027 年苹果硬件创新、端侧 AI 模型升级及新品周期仍值得期待。与此同时，苹果、微软、Meta、谷歌、OpenAI、亚马逊、三星、华为等大厂持续布局 AI/AR 眼镜、机器人、AI 玩具及 AIoT 等新型终端加快发展。下半年伴随消费电子新品密集发布及端侧 AI 功能进一步落地，相关硬件创新有望持续推进；中长期看好 AR 智能眼镜光波导、SoC 芯片及核心零部件方向，随着技术成熟及产品体验改善，2027 年有望逐步进入放量阶段。建议关注：蓝特光学、立讯精密、东山精密、水晶光电、鹏鼎控股、瑞芯微、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、恒玄科技。

五、风险提示

AI 技术迭代及商业化进展不及预期的风险：全球科技巨头持续加大 AI 基础设施及模型投入，若 AI 应用落地及商业化进展不及预期，或模型迭代带来的算力需求增长弱于预期，可能导致云厂商资本开支及 AI 硬件需求增速放缓，对相关产业链公司业绩产生影响。

外部制裁进一步升级的风险：全球贸易摩擦及科技领域出口管制持续，若美国、日本、荷兰等国家和地区进一步收紧半导体设备、零部件、材料及先进芯片相关出口限制，可能导致部分企业供应链、客户拓展及产品研发进度受到影响。

上游原材料价格上涨及成本传导不及预期的风险：PCB、消费电子等产业链涉及铜、铜箔、电子布、树脂等多类原材料，若原材料价格持续上涨，而相关企业向下游客户的价格传导不及预期，可能对产品毛利率及盈利能力产生不利影响。

终端需求不及预期的风险：若智能手机、PC 等消费电子终端创新及换机需求低于预期，AI 手机、AIPC、智能眼镜等新型终端渗透速度不及预期，或汽车、工业等下游需求恢复弱于预期，可能对相关产业链公司的收入增长及盈利能力产生影响。

行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海
电话：021-80234211
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn
邮编：201204
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 5 楼

北京
电话：010-85950438
邮箱：researchbj@gjzq.com.cn
邮编：100005
地址：北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 8 层南侧

深圳
电话：0755-86695353
邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：518000
地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806

【小程序】
国金证券研究服务

【公众号】
国金证券研究